

목 차

분기 보고서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	6
3. 원재료 및 생산설비	7
4. 매출 및 수주상황	14
5. 위험관리 및 파생거래	19
6. 주요계약 및 연구개발활동	26
7. 기타 참고사항	32
III. 재무에 관한 사항	53
1. 요약재무정보	53
2. 연결재무제표	56
2-1. 연결 재무상태표	56
2-2. 연결 손익계산서	58
2-3. 연결 포괄손익계산서	59
2-4. 연결 자본변동표	60
2-5. 연결 현금흐름표	61
3. 연결재무제표 주식	63
4. 재무제표	131
4-1. 재무상태표	131
4-2. 손익계산서	133
4-3. 포괄손익계산서	134
4-4. 자본변동표	135
4-5. 현금흐름표	136
5. 재무제표 주식	137
6. 배당에 관한 사항	196
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	199
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	199
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	203
8. 기타 재무에 관한 사항	204
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	227
V. 회계감사인의 감사의견 등	228
1. 외부감사에 관한 사항	228
2. 내부통제에 관한 사항	235
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	236
1. 이사회에 관한 사항	236
2. 감사제도에 관한 사항	236
3. 주주총회 등에 관한 사항	236

VII. 주주에 관한 사항.....	237
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	244
1. 임원 및 직원 등의 현황.....	244
2. 임원의 보수 등	295
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	296
X. 대주주 등과의 거래내용	297
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.....	300
1. 공시내용 진행 및 변경사항	300
2. 우발부채 등에 관한 사항	300
3. 제재 등과 관련된 사항.....	302
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	302
XII. 상세표.....	303
1. 연결대상 종속회사 현황(상세).....	303
2. 계열회사 현황(상세).....	303
3. 타법인출자 현황(상세).....	303
4. 연구개발실적(상세)	304
【 전문가의 확인 】	329
1. 전문가의 확인.....	329
2. 전문가와의 이해관계	329

분기보고서

(제 55 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

한 종 희

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2023년 3분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2023. 11. 14

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 회



신고업무 담당임원: 박 학 규



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 등의 디스플레이 패널을 생산·판매하고 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience) 사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 35개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 198개의 비상장 중속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 70개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과, 스마트폰 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2023년 3분기 당사의 매출은 191조 1,556억원으로 전년 동기 대비 17.5% 감소하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

2023년 3분기 매출은 DX 부문이 130조 4,441억원(68.2%), DS 부문이 44조 9,021억원(23.5%)이며, SDC가 21조 3,158억원(11.2%), Harman은 10조 4,641원(5.5%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,304,441	68.2%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	449,021	23.5%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	213,158	11.2%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	104,641	5.5%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△159,705	△8.4%
총 계		1,911,556	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2023년 3분기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 3% 하락하였으며, 스마트폰 등은 전년 연간 평균 대비 약 13% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비 약 48% 하락하였으며, 디스플레이 패널(스마트폰용 OLED 패널)은 약 3% 상승하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간 평균과 유사한 수준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기(주) 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인(주), SK실트론(주) 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 (주)비에이치, Biel 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다

(단위 : 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	모바일AP 솔루션	CPU	89,898	18.1%	Qualcomm, MediaTek 등
	디스플레이 패널	TV·모니터용 화면표시장치	43,764	8.8%	CSOT, AUO 등
	Camera Module	스마트폰 카메라	39,342	7.9%	삼성전기(주), 파워로직스 등
	기타	-	324,229	65.2%	
	소 계			497,233	100.0%
DS 부문	Chemical	원판 가공	19,574	16.2%	솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등
	Wafer	반도체 원판	16,655	13.8%	SK실트론(주), Siltronic 등
	기타	-	84,890	70.0%	
	소 계			121,119	100.0%
SDC	FPCA	구동회로	17,003	21.9%	(주)비에이치, 영풍전자 등
	Cover Glass	강화유리	12,770	16.5%	Apple, Biel 등
	기타	-	47,817	61.6%	
	소 계			77,590	100.0%
Harman	SOC(System-On-Chip)	CPU	5,820	16.1%	NVIDIA, Intel 등
	통신 모듈	차량 통신	3,808	10.5%	WNC(Wistron NeWeb Corp.) 등
	기타	-	26,591	73.4%	
	소 계			36,219	100.0%
기타	-	-	297	-	
총 계			732,458	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년 반기부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함) 가격으로, DX부문 주요 원재료 현황을 작성하였습니다.

매입액(억원)	2023년 1분기	2022년	2021년
모바일AP 솔루션	31,450	113,790	76,295

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 연간 평균 대비 약 28% 상승하였고, Camera Module 가격은 약 8% 상승하였으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 5% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 연간 평균 대비 약 1% 상승하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 5% 상승, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 2% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip)가격은 전년 연간 평균 대비 약 10% 상승하였으며, 통신 모듈은 약 7% 하락하였습니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년 반기부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함) 가격으로, DX부문 주요 원재료 가격 변동 추이를 작성하였습니다.

가격변동추이	2023년 1분기	2022년	2021년
모바일AP 솔루션	전년 대비 37% 상승	전년 대비 46% 상승	전년과 유사한 수준

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제55기 3분기	제54기	제53기
DX 부문	TV, 모니터 등	39,931	55,747	54,235
	스마트폰 등	218,000	332,170	319,550
DS 부문	메모리	1,404,934,414	1,905,731,836	1,756,009,941
SDC	디스플레이 패널	1,723	2,700	3,604
Harman	디지털 콕핏	8,149	11,257	9,066

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass (2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2023년(제55기) 3분기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 30,207천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 145,798천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 1,404,934백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 997천개이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 5,944천개입니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제55기 3분기	제54기	제53기
DX 부문	TV, 모니터 등	30,207	41,802	44,133
	스마트폰 등	145,798	229,180	260,501
DS 부문	메모리	1,404,934,414	1,905,731,836	1,756,009,941
SDC	디스플레이 패널	997	2,008	2,849
Harman	디지털 콕핏	5,944	8,334	6,928

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2023년(제55기) 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 75.6%, 스마트폰 등은 66.9%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제55기 3분기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	TV, 모니터 등	39,931	30,207	75.6%
	스마트폰 등	218,000	145,798	66.9%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2023년(제55기) 3분기 누적 가동일은 휴일을 포함하여 총 273일입니다. 가동률은 가동 가능시간 (가동일 × 생산라인 수 × 24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제55기 3분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	65,520	65,520	100%
SDC	디스플레이 패널	32,760	32,760	100%

Harman의 2023년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 72.9%입니다.

(단위 : 천개)

부 문	품 목	제55기 3분기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	8,149	5,944	72.9%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 중속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (복수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucrí Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany
	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년 3분기말 현재 장부금액은 180조 8,060억원으로 전년말 대비 12조 7,606억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기 초	기초장부금액	98,922	407,069	797,146	336,076	41,241	1,680,454
	- 취득원가	100,246	677,138	3,030,006	336,076	132,485	4,275,951
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,324	△270,069	△2,232,860	-	△91,244	△2,595,497
증 감	일반취득 및 자본적지출	1,618	39,990	226,252	105,152	9,855	382,867
	감가상각	△368	△28,613	△223,775	-	△11,935	△264,691
	처분·폐기·손상	△174	△1,878	△367	-	△233	△2,652
	기타	351	6,587	3,431	1,103	610	12,082
기 말	기말장부금액	100,349	423,155	802,687	442,331	39,538	1,808,060
	- 취득원가	101,921	721,518	3,212,454	442,331	139,229	4,617,453
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,572	△298,363	△2,409,767	-	△99,691	△2,809,393

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2023년 3분기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 36.7조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2023년 글로벌 시황 악화에도 불구하고 미래 경쟁력 강화 및 중장기 수요대비를 위한 투자를 지속적으로 추진 중이며, 내실 강화를 위한 투자 효율성 제고 활동도 병행할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신·증설, 보완 등	2023.01~2023.09	건물·설비 등	334,408
SDC	신·증설, 보완 등	2023.01~2023.09	건물·설비 등	15,862
기 타	신·증설, 보완 등	2023.01~2023.09	건물·설비 등	16,727
합 계				366,997

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2023년 3분기 매출은 191조 1,556억원으로 전년 동기 대비 17.5% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 6.7%, DS 부문이 42.7%, SDC는 15.0% 감소하였으며, Harman은 12.8% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제55기 3분기	제54기	제53기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	1,304,441	1,824,897	1,662,594
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	449,021	984,553	953,872
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	213,158	343,826	317,125
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	104,641	132,137	100,399
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△159,705	△263,099	△237,942
합 계			1,911,556	3,022,314	2,796,048

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제55기 3분기	제54기	제53기
TV, 모니터 등	219,991	332,795	314,974
스마트폰 등	846,022	1,154,254	1,046,806
메모리	284,144	685,349	726,022
디스플레이 패널	213,158	343,826	317,125

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제55기 3분기	제54기	제53기
제·상품	1,795,427	2,903,461	2,658,785
용역 및 기타매출	116,129	118,853	137,263
계	1,911,556	3,022,314	2,796,048

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제55기 3분기	제54기	제53기
내수	국내	165,466	221,799	221,497
	미주	394,039	659,617	583,805
수출	유럽	180,204	265,147	258,227
	아시아·아프리카	245,494	425,114	336,671
	중국	292,437	546,998	597,247
계		1,277,640	2,118,675	1,997,447

※ 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판매 경로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인)	

(2) 해외

판매자	판매 경로			소비자		
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer	Retailer			
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM				
		직접판매(B2B 및 온라인)				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
Distributor			Dealer	Retailer		

(3) 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	19%	31%	45%	5%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2023년 3분기 당사의 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 15% 수준입니다.

바. 수주상황

2023년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화 외 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 방향으로 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다

2023년 3분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 65,826백만원(전분기: 88,571백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,519백만원(전분기: 3,170백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없었던 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2023년 3분기말 현재 당사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기말	제54기말
부 채	90,573,804	93,674,903
자 본	363,892,643	354,749,604
부채비율	24.9%	26.4%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2023년 3분기말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 36개 통화에 대하여 2,646건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	132,578	64,774	625,471	763,850

그리고 당사는 레인보우로보틱스(주) 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스(주)의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스(주) 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 2023년 3분기말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

삼성디스플레이(주)는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

2023년 3분기말 현재 상기 풋옵션들 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 · 부제소를 통한 사업자유도 확보
Apple	계약 유형	소취하 계약
	체결시기	2018.06.26
	목적 및 내용	양사 간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하
Nokia	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 사업자유도 확보
Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2023.07.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2023.01.01~2023.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한라이선스 계약
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 확보로 사업 자유도 확보
AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약
	체결시기	2019.05.30
	목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보
Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약

	체결시기	2019.07.30
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

※ 계약 체결 금액 등은 영업기밀에 해당되어 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2023년(제55기) 3분기 당사의 연구개발비용은 20조 7,997억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 20조 7,898억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

과 목		제55기 3분기	제54기	제53기
연구개발비용 총계		20,799,740	24,929,171	22,596,487
(정부보조금)		△9,908	△9,973	△1,053
연구개발비용 계		20,789,832	24,919,198	22,595,434
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	△193,708
	연구개발비(비용)	20,789,832	24,919,198	22,401,726
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		10.9%	8.2%	8.1%

※ 연결 누계기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

다. 연구개발 조직 및 운영

(국내)

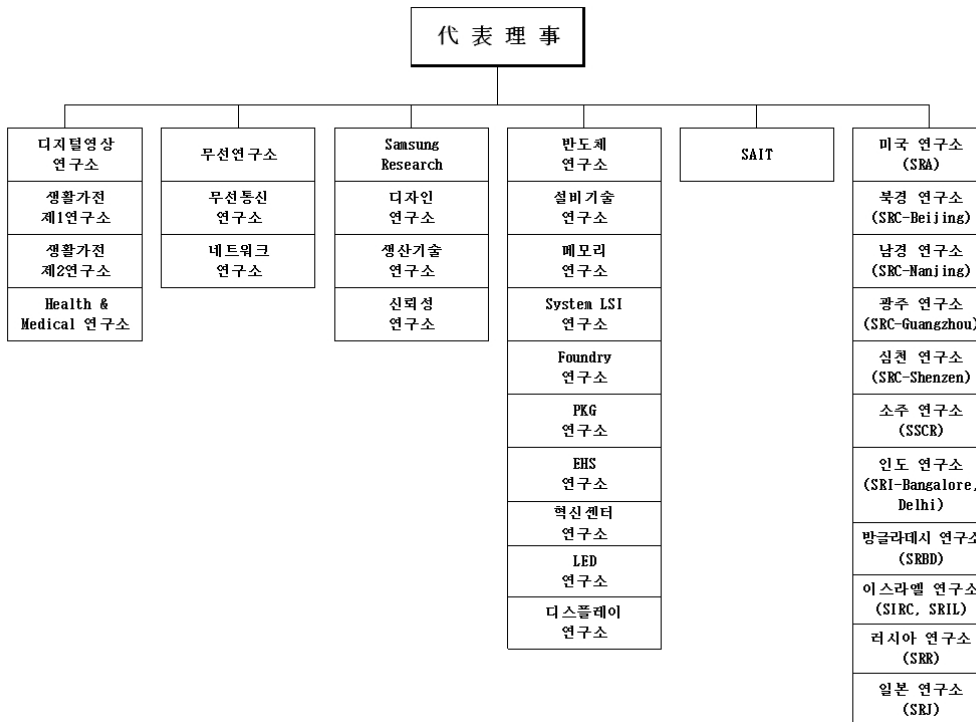
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문 연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 SAIT 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

SAIT는 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래 성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzen), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SRIL, SIRC), 러시아(SRR), 일본(SRJ) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등의 연구 활동을 수행 중입니다.

또한, 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토·몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가와 한국·미국 등의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2023년 3분기말 기준입니다.

라. 연구개발실적

2023년 3분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	갤럭시 폴더블	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy Z Fold5 출시 Galaxy Z Flip5 출시
	갤럭시 S23	Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra 출시
	갤럭시 탭	Galaxy Tab S9 출시
	갤럭시 A	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy A54 5G 출시 Galaxy A34 5G 출시 Galaxy A24 LTE 출시 Galaxy A14 LTE · 5G 출시
	갤럭시북	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy Book3 Ultra 출시 Galaxy Book3 Pro 360 출시 Galaxy Book3 Pro 출시 Galaxy Book3 360 출시
	웨어러블	Galaxy Watch6/ Galaxy Watch6 Classic 출시
	Neo QLED 8K	Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	청소기	세계최고 성능(흡입력/사용시간) 스틱 청소기 BESPOKE 제트AI 280W 출시
	기지국	최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발
DS 부문	모바일 DRAM	업계 최초 LPCAMM 개발
	서버용 DRAM	<ul style="list-style-type: none"> 업계 최선단 12나노급 D램 양산 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
	SSD	5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산
	엑시노스	<ul style="list-style-type: none"> 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 출시
	이미지센서	초고화소 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)
SDC	OLED	<ul style="list-style-type: none"> 초고해상도 VR용 OLED 개발 노트북용 14/16" OLED 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 239,605건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2023년 3분기말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	56,412	92,090	44,064	22,685	8,963	15,391	239,605

2023년 3분기 중 총 20.8조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 6,669건, 미국 특허 6,704건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년
한국	6,669	9,136	8,437
미국	6,704	8,490	8,565

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선형 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2022.07.), Nokia(2023.01.), Microsoft(2023.07.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2023년 3분기 중 미국에서 306건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건 경영시스템 인증 (ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서 「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」 제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO₂-eq, TJ)

구 분	2022년	2021년	2020년
온실가스(tCO ₂ -eq)	19,285,537	19,267,835	17,234,522
에너지(TJ)	290,111	274,298	255,990

- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산·판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV 산업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송의 확산 등을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 가격 경쟁력 있는 제품 출시를 통해 성장을 지속하며 기존의 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다.

2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

2) 휴대폰 산업

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2022년에 판매된 휴대폰의 82%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: TechInsights 2023.09).

또한, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2022년 6.8억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2023.09).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2022년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 82% 수준, 피쳐폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 18% 수준입니다(출처: TechInsights 2023.09). 또한 스마트폰 보급률은 2022년 52%에서 2023년 53%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.07).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티 카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

2022년 TV 전체 시장 수요는 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재·에너지 공급 불안정, 글로벌 인플레이션 확대에 따른 가계 실질 소득 감소 영향 등으로 전년비 역성장하여 약 2억 328만대 수준이었습니다. 그러나 2023년은 유럽 및 중국 지역 하락세를 아시아 및 중동/아프리카 성장세가 상쇄하면서 전년과 동등 수준인 약 2억 352만대로 전망하고 있습니다.(출처: Omdia 2023.09).

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2023년 3분기	2022년	2021년
TV	30.5%	29.7%	29.5%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장 점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2023년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

2) 휴대폰 산업

스마트폰 시장은 지정학적 불안 지속, 인플레이션 등 불확실성으로 인해 2022년 12.0억대에서 2023년 11.3억대 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2023.09). 그동안 교체 수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향 등에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 2022년에는 1.6억대 수준으로 감소하였으며, 2023년에도 1.4억대 수준으로 감소할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.09).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2023년 3분기	2022년	2021년
스마트폰	20.8%	21.7%	20.0%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

※ TechInsights는 기존 외부조사기관인 Strategy Analytics를 인수하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2022년까지 17년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K·8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프리미엄 제품군을 확대하였습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar 제품의 판매 비중도 상승하였으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되었습니다. 특히, 당사는 2021년부터 제품 재질부터 패키징(Packaging)에 이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각·청각 장애인도 불편없이 제품을 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년에는 Neo QLED 8K 혁신 기술들을 중심으로 75" 이상 초대형 프리미엄 시장 점유율을 확대해가는 한편, 더 프리스타일 제품을 도입하여 라이프스타일 라인업을 더욱 보강하였습니다.

2023년에는 당사의 주력 제품인 Neo QLED와 초대형 등 프리미엄 제품에 집중해 시장 점유율을 확대해 나가는 한편 라이프스타일 쪽에서도 라인업 확대와 제품 성능 개선 등을 통해 소비자 맞춤형 제품들을 지속적으로 제공할 것입니다. 또한, 전사 차원의 친환경 경영전략에 맞춰 재생 플라스틱을 활용한 소재를 친환경 리모컨에 추가 확대 적용하고 초전력 기술을 적용한 TV 신제품들도 선보일 예정입니다.

2) 휴대폰 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 12년 연속 글로벌 출하량 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 콘텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수·방진, 고속 유·무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율·야간 촬영, 8K 동영상 등 고객의 Needs에 기반한 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'을 출시하였습니다. 갤럭시 Z 플립 시리즈는 아이코닉하고 젊은 감성의 디자인으로 여성과 젊은 세대의 갤럭시 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 3세대, 4세대 갤럭시 Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 리딩해 왔습니다.

2023년 출시한 갤럭시 S23 시리즈는 소비자가 일상에서 체감할 수 있는 제품 경험을 한 단계 높여 당사의 기술 리더십을 공고히 하고자 노력하였습니다. 특히 갤럭시 S23 Ultra는 2억 화소 이미지 센서를 기반으로 더욱 개선된 야간 촬영 및 Zoom기능을 제공하고, 고용량 메모리 및 친환경 소재 적용을 확대하여 좋은 반응을 이끌어 내었습니다.

또한, '갤럭시 Z 폴드5'와 '갤럭시 Z 플립5'는 사용자 관점에서 각 제품의 핵심 경험인 멀티태스킹과 Flex Mode 경험의 완성도를 더욱 높여 시장의 호응을 받고 있습니다. 당사는 새로운 폴더블 시리즈의 진정한 대중화로 기존 노트 시리즈 이상의 판매량을 달성할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

더불어, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display, 고용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품 경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹 등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 혁신적인 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, Bixby 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 SmartThings를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 자연스러운 연결 경험을 체감할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings, Bixby, Cloud를 활용하고 당사의 방대한 글로벌 Installed base 기반 서비스 사업 강화를 통해 수익 구조를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 갤럭시 S22 및 S23 시리즈, 갤럭시Z 폴드5 및 갤럭시Z 플립5 등 주요 제품에 적용하였습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용 프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지 센서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 매크로 경기 불확실성에 따른 고객사의 IT 투자 제한으로 일반 서버 수요가 상대적으로 약세를 보였으나, AI향 고용량/고사양 제품 수요는 강세가 지속되었습니다. PC/모바일은 고용량 채용 증대와 고객사 완제품 재고 조정 마무리로 수요 환경이 개선되었습니다. 당사는 수익성 중심 사업 운영을 기조로 DDR5 및 HBM, LPDDR5x, UFS4.0 등 선단 인터페이스 제품의 판매를 확대하였고, 상대적으로 재고수준이 높은 제품은 생산량 조정으로 재고 수준을 낮추는데 집중하였습니다.

Foundry 시장은 응용처별 재고 안정화 추세에도 불구하고, SET 시장 수요 회복이 지연됨에 따라 예상보다 더딘 회복이 전망됩니다. 다만, 주요 업체의 Flagship 스마트폰 출시에 따른 수요 증가와 공급망 정상화, AI 관련 고성능 컴퓨팅 수요/응용 확대 등에 따라 점진적 회복을 기대하는 시각도 있습니다. 한편, 중장기는 모바일 수요와 자율주행향 고성능 SoC 수요 증가 등으로 지속적인 성장세가 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2023년 3분기	2022년	2021년
DRAM	41.0%	43.1%	43.0%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(2023년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

메모리는 PC/모바일의 연말 프로모션과 모바일 주요 고객사의 신제품 출시 등 계절적 성수기 효과로 4분기 수요 개선이 전망됩니다. 서버는 클라우드 서비스 고객들의 CAPEX가 생성형 AI향으로 집중됨에 따라, 이와 관련된 수요는 지속 강세가 예상됩니다. 더불어, 서버 및 스토리지 OEM과 데이터센터 고객도 메모리 시황 저점 인식 확산과 함께 연말로 갈수록 고객사 재고 수준이 정상화 됨에 따라 구매 확대 추세를 보이고 있습니다. 이에, 당사는 DDR5, LPDDR5x 및 PCIe Gen5, UFS4.0 등 신규 인터페이스 제품의 고객 수요 증가에 적극 대응하는 가운데, 고수익 제품군인 Automotive향 판매 비중 확대와 AI 수요 증가에 따른 주요 고객사향 HBM3 양산 판매도 지속 확대해 나갈 계획입니다.

System LSI는 글로벌 경기 침체 및 중국 Mobile 시장 정체 지속으로 시장 반등이 불확실할 것으로 전망되나, 고객과의 협력 강화, 차세대 신제품 적기 개발, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 극복해 나가고 있습니다. 특히 SOC는 고성능 CPU/GPU/NPU 등을 탑재한 모바일SOC 신제품 개발, 자동차향 SOC 등 제품 라인업 확대 하고 있으며, 모바일 위성 통신 서비스 등 차세대 기술 개발도 고객과 협력을 통해 강화하고 있습니다. 이미지 센서는 당사 우위의 미세 픽셀 기술력을 바탕으로 1억 및 2억화소 센서를 후면 메인, 줌 차별화 적용으로 고화소 센서의 시장 확대를 주도하고 있으며 자동차향 센서 신규 거래선 진입 확대와 차세대센서 선행 연구 강화 등 중장기 성장을 위한 미래 기술 준비도 차질없이 수행하고 있습니다.

Foundry는 시장 회복을 대비하여 사업 전 영역에서 준비를 하고 있습니다. Advanced 노드인 3나노 GAA(Gate All Around) 1세대 공정은 안정적인 수율 기반 양산 중이며, 2세대 공정은 계획한 일정에 차질없이 개발 중에 있습니다. 4나노 2/3세대 제품 또한 안정적인 수율을 기반으로 양산을 시작하여, 시장에서 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. Advanced 노드의 지속적인 기술경쟁력 강화를 통한 미래 먹거리 확보와 공급 극대화를 위한 생산성 향상을 준비/실행하고 있습니다. 더불어 평택·테일러 등 신규 FAB 구축을 기반으로 적기 공급 능력 확대 또한 차질없이 준비 중입니다. Matured 노드는 신규 수요 발굴 및 기존 물량 확대를 위해 공정 기술 개선 및 원가 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 특히, 고성능 컴퓨팅/전장향/5G/IoT 등 신규 분야로 포트폴리오 다각화를 진행하고 있으며, 스페셜티 공정을 활용한 제품을 개발/공급하고자 고객들과 협력하고 있습니다. 시장 회복은 더딘 상황이나, 고객과 지속 협력하며 입지를 견고히 함과 동시에 사업 확대를 위한 기반을 구축하겠습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블, 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수 나노 미터의반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2022년 13.8억대에서 2023년 13.6억대로 다소 축소될 것으로 전망됩니다. 반면 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2022년 5.7억대에서 2023년 5.9억대로 확대될 것으로 전망되며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2022년 42%에서 2023년 43%로 소폭 상승할 것으로 전망됩니다.(출처: Omdia 2023.09).

대형 디스플레이 패널 시장은 2022년 9.0억대였으며, 2023년은 8.3억대로 감소할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2023.09).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2023년 3분기	2022년	2021년
스마트폰 패널	52.7%	56.7%	51.4%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2023년 3분기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, 전장 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2023년은 글로벌 경기 침체 영향으로 수요 회복이 지연될 것으로 예상됩니다. 당사는 폴더블 성능 향상을 통해 Mainstream 제품에 진입하고, 고객사 Needs에 발맞춰 고휘도, 저전력 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 원가 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 지속적으로 높여가기 위해 노력하겠습니다.

또한, 8.6G IT OLED라인 투자를 본격화 하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, Automotive 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

한편, 대형 디스플레이 사업은 QD-OLED 제품의 라인업 확대 및 판매처 다변화를 통해 프리미엄 시장에서의 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다. 이중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 단순 이동수단이 아닌 이동시에 즐기는 차량내 경험(In-Cabin Experience)를 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등)을 활용하여 보다 편리하고 개인화된 맞춤형 경험을 제공하여 차별화하는데 주력하고 있습니다.

특히, 차량의 IT 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화로 인해, 자동차 제조사들은 중앙집중형 아키텍처의 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 변화를 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 기술 변화에 따른 업체간 경쟁은 치열할 것으로 예상됩니다.

이로 인해 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시장에서 주요 업체(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)간 경쟁이 매우 치열합니다. Harman은 카 오디오(Car Audio) 분야에서 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic 등) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향 관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오 제품(TWS(True Wireless Stereo), 포터블 스피커, 헤드폰 등)은 과거에 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술이 적용되고 AI(Artificial Intelligence)가 탑재됨에 따라 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 변화에 따라, 사운드 재생 기술을 보유한 전통적인 오디오 업체들로 구성된 소비자 오디오 시장에 IT 업체들이 진입하여 경쟁하고 있습니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Wifi Home 스피커 및 게이밍 스피커 분야에서 고성장이 예상되며, 특히 휴대폰 제조사가 높은 시장점유율을 차지하고 있는 TWS 분야는 지속 성장이 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용 · 대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha가 현재 산업 내에서 널리 알려진 선도 업체입니다.

(국내외 시장여건 등)

반도체 및 원자재 공급망의 어려움이 지속되고 있고, 자동차 노조의 파업은 북미 자동차 공급시장에 추가적인 부담을 주었습니다. 세계 각국 중앙은행이 인플레이션에 대응하기 위해 추가적인 긴축 정책을 시행하는 등 거시경제의 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들을 감안하였을때 2024년 전세계 자동차 생산은 2023년 대비 2% 수준 증가에 그칠 것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2023.09).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2023년 3분기	2022년	2021년
디지털 콕핏	20.0%	24.7%	25.3%

※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.

※ 시장점유율은 외부조사기관인 I.H.S 와 LMC의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

또한 Harman은 Digital Transformation Solutions 사업을 지속적으로 발전시켜 왔습니다. DTS는 디지털, 교차 채널 사용자 경험, 클라우드, 이동성, 통찰력 있는 데이터 및 확장 가능한 기본 IT 플랫폼을 기반으로 하는 사물 인터넷의 수렴을 통해 고객에게 전체적인 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

글로벌 지정학적 불안정 속 거시경제환경 악화 등 어려운 경영환경이 예상되지만, Harman은 고객사와의 협업을 통해 위험을 최소화할 수 있도록 하겠습니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2023년(제55기) 3분기 매출은 DX 부문이 130조 4,441억원(68.2%), DS 부문이 44조 9,021억원(23.5%)이며, SDC가 21조 3,158억원(11.2%), Harman은 10조 4,641억원(5.5%)입니다.

2023년(제55기) 3분기 영업이익은 DX 부문이 11조 7,662억원, DS 부문이 △12조 6,976억원, SDC가 3조 5,543억원, 그리고 Harman은 8,306억원입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제55기 3분기		제54기		제53기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	1,304,441	68.2%	1,824,897	60.4%	1,662,594	59.5%
	영업이익	117,662	314.4%	127,461	29.4%	173,866	33.7%
	총자산	2,381,906	37.8%	2,279,669	38.6%	2,479,832	42.0%
DS 부문	매출액	449,021	23.5%	984,553	32.6%	953,872	34.1%
	영업이익	△126,976	△339.3%	238,158	54.9%	291,920	56.5%
	총자산	2,809,412	44.6%	2,620,558	44.3%	2,258,223	38.3%
SDC	매출액	213,158	11.2%	343,826	11.4%	317,125	11.3%
	영업이익	35,543	95.0%	59,530	13.7%	44,574	8.6%
	총자산	815,812	12.9%	737,798	12.5%	668,836	11.3%
Harman	매출액	104,641	5.5%	132,137	4.4%	100,399	3.6%
	영업이익	8,306	22.2%	8,805	2.0%	5,991	1.2%
	총자산	183,488	2.9%	171,023	2.9%	158,874	2.7%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제55기 3분기 2023년 9월말	제54기 2022년 12월말	제53기 2021년 12월말
[유동자산]	206,438,600	218,470,581	218,163,185
· 현금및현금성자산	75,144,284	49,680,710	39,031,415
· 단기금융상품	17,927,266	65,102,886	81,708,986
· 기타유동금융자산	31,340	443,690	3,409,791
· 매출채권	43,405,955	35,721,563	40,713,415
· 재고자산	55,255,957	52,187,866	41,384,404
· 기타	14,673,798	15,333,866	11,915,174
[비유동자산]	248,027,847	229,953,926	208,457,973
· 기타비유동금융자산	10,361,601	12,802,480	15,491,183
· 관계기업 및 공동기업 투자	11,633,753	10,893,869	8,932,251
· 유형자산	180,805,963	168,045,388	149,928,539
· 무형자산	23,137,000	20,217,754	20,236,244
· 기타	22,089,530	17,994,435	13,869,756
자산총계	454,466,447	448,424,507	426,621,158
[유동부채]	73,625,180	78,344,852	88,117,133
[비유동부채]	16,948,624	15,330,051	33,604,094
부채총계	90,573,804	93,674,903	121,721,227
[지배기업 소유주지분]	353,680,186	345,186,142	296,237,697
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	342,125,419	337,946,407	293,064,763
· 기타	6,253,360	1,938,328	△2,128,473
[비지배지분]	10,212,457	9,563,462	8,662,234
자본총계	363,892,643	354,749,604	304,899,931
	2023년 1월~9월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월
매출액	191,155,556	302,231,360	279,604,799
영업이익	3,742,259	43,376,630	51,633,856
연결총당기순이익	9,142,342	55,654,077	39,907,450
· 지배기업 소유주지분	8,449,574	54,730,018	39,243,791
· 비지배지분	692,768	924,059	663,659
기본주당순이익(단위 : 원)	1,244	8,057	5,777
희석주당순이익(단위 : 원)	1,244	8,057	5,777
연결에 포함된 회사수	234개	233개	229개

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제54기 연결감사보고서 및 제55기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제55기 3분기	제54기	제53기
	2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	74,844,254	59,062,658	73,553,416
· 현금및현금성자산	10,539,545	3,921,593	3,918,872
· 단기금융상품	1,268	137	15,000,576
· 매출채권	26,809,541	20,503,223	33,088,247
· 재고자산	32,102,177	27,990,007	15,973,053
· 기타	5,391,723	6,647,698	5,572,668
[비유동자산]	219,646,193	201,021,092	177,558,768
· 기타비유동금융자산	1,853,222	1,364,608	1,664,667
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,356,927	57,397,249	56,225,599
· 유형자산	134,588,738	123,266,986	103,667,025
· 무형자산	10,843,890	8,561,424	8,657,456
· 기타	15,003,416	10,430,825	7,344,021
자산총계	294,490,447	260,083,750	251,112,184
[유동부채]	38,156,918	46,086,047	53,067,303
[비유동부채]	30,125,495	4,581,512	4,851,149
부채총계	68,282,413	50,667,559	57,918,452
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	221,190,271	204,388,016	188,774,335
[기타]	△283,644	△273,232	△882,010
자본총계	226,208,034	209,416,191	193,193,732
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2023년 1월~9월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월
매출액	127,763,991	211,867,483	199,744,705
영업이익	△9,774,852	25,319,329	31,993,162
당기순이익	24,159,539	25,418,778	30,970,954
기본주당순이익(단위 : 원)	3,557	3,742	4,559
희석주당순이익(단위 : 원)	3,557	3,742	4,559

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제54기 감사보고서 및 제55기 분기 검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 55 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 54 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기말	제 54 기말
자산		
유동자산	206,438,600	218,470,581
현금및현금성자산	75,144,284	49,680,710
단기금융상품	17,927,266	65,102,886
단기상각후원가금융자산	0	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	31,340	29,080
매출채권	43,405,955	35,721,563
미수금	6,369,452	6,149,209
선급비용	3,147,532	2,867,823
재고자산	55,255,957	52,187,866
기타유동자산	5,156,814	6,316,834
비유동자산	248,027,847	229,953,926
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,847,905	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	1,513,696	1,405,468
관계기업 및 공동기업 투자	11,633,753	10,893,869
유형자산	180,805,963	168,045,388
무형자산	23,137,000	20,217,754
순확정급여자산	4,842,172	5,851,972
이연법인세자산	6,535,442	5,101,318
기타비유동자산	10,711,916	7,041,145
자산총계	454,466,447	448,424,507
부채		
유동부채	73,625,180	78,344,852
매입채무	13,157,077	10,644,686
단기차입금	4,342,183	5,147,315
미지급금	14,095,875	17,592,366
선수금	1,416,806	1,314,934
예수금	835,013	1,298,244
미지급비용	25,941,605	29,211,487
당기법인세부채	3,411,695	4,250,397
유동성장기부채	1,275,269	1,089,162
유동충당부채	7,067,326	5,844,907
기타유동부채	2,082,331	1,951,354
비유동부채	16,948,624	15,330,051

사채	567,683	536,093
장기차입금	3,864,903	3,560,672
장기미지급금	5,469,799	2,753,305
순확정급여부채	439,238	268,370
이연법인세부채	1,070,601	5,111,332
장기충당부채	2,681,437	1,928,518
기타비유동부채	2,854,963	1,171,761
부채총계	90,573,804	93,674,903
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	353,680,186	345,186,142
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	342,125,419	337,946,407
기타자본항목	6,253,360	1,938,328
비지배지분	10,212,457	9,563,462
자본총계	363,892,643	354,749,604
부채와자본총계	454,466,447	448,424,507

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기		제 54 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	67,404,652	191,155,556	76,781,680	231,766,785
매출원가	46,618,726	134,273,009	48,072,237	141,414,042
매출총이익	20,785,926	56,882,547	28,709,443	90,352,743
판매비와관리비	18,352,392	53,140,288	17,857,398	51,282,244
영업이익	2,433,534	3,742,259	10,852,045	39,070,499
기타수익	244,352	949,823	316,184	1,480,348
기타비용	206,403	579,442	283,534	1,337,037
지분법이익	262,677	676,459	312,846	804,552
금융수익	4,112,158	12,797,135	6,758,972	15,633,046
금융비용	2,903,717	10,104,258	6,101,555	14,265,852
법인세비용차감전순이익(손실)	3,942,601	7,481,976	11,854,958	41,385,556
법인세비용(수익)	(1,901,570)	(1,660,366)	2,465,760	9,572,925
계속영업이익(손실)	5,844,171	9,142,342	9,389,198	31,812,631
당기순이익(손실)	5,844,171	9,142,342	9,389,198	31,812,631
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,501,304	8,449,574	9,143,900	31,227,509
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	342,867	692,768	245,298	585,122
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	810	1,244	1,346	4,597
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	810	1,244	1,346	4,597

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기		제 54 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	5,844,171	9,142,342	9,389,198	31,812,631
기타포괄손익	1,572,861	7,468,617	10,064,296	15,554,110
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(362,602)	781,034	(419,542)	(2,328,730)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(326,750)	1,144,740	(359,582)	(2,159,526)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	3,617	26,314	(25,788)	(37,663)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(39,469)	(390,020)	(34,172)	(131,541)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,935,463	6,687,583	10,483,838	17,882,840
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	34,057	119,485	173,955	208,801
해외사업장환산외환차이	1,914,792	6,568,676	10,316,906	17,673,153
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(13,386)	(578)	(7,023)	886
총포괄손익	7,417,032	16,610,959	19,453,494	47,366,741
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	7,089,926	15,851,327	19,091,717	46,589,763
비지배지분	327,106	759,632	361,777	776,978

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본						
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익			31,227,509		31,227,509	585,122	31,812,631
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(44,716)	(2,093,934)	(2,138,650)	(20,876)	(2,159,526)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				170,037	170,037	1,101	171,138
해외사업장환산외환차이				17,461,541	17,461,541	211,612	17,673,153
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(131,560)	(131,560)	19	(131,541)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				886	886		886
배당			7,357,284		7,357,284	2,200	7,359,484
연결실체내 자본거래 등						(973)	(973)
연결실체의 변동						150	150
기타						524	524
2022.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	316,890,272	13,278,497	335,470,176	9,436,713	344,906,889
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604
당기순이익			8,449,574		8,449,574	692,768	9,142,342
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			3,086,721	(1,952,180)	1,134,541	10,199	1,144,740
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				143,912	143,912	1,887	145,799
해외사업장환산외환차이				6,513,750	6,513,750	54,926	6,568,676
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(389,872)	(389,872)	(148)	(390,020)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(578)	(578)		(578)
배당			7,357,283		7,357,283	101,939	7,459,222
연결실체내 자본거래 등						(9,439)	(9,439)
연결실체의 변동						250	250
기타						491	491
2023.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	342,125,419	6,253,360	353,680,186	10,212,457	363,892,643

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기	제 54 기 3분기
영업활동 현금흐름	24,192,198	43,568,446
영업에서 창출된 현금흐름	26,320,066	51,608,511
당기순이익	9,142,342	31,812,631
조정	30,111,057	41,634,955
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(12,933,333)	(21,839,075)
이자의 수취	3,771,363	1,229,543
이자의 지급	(686,134)	(481,029)
배당금 수입	61,552	489,967
법인세 납부액	(5,274,649)	(9,278,546)
투자활동 현금흐름	7,599,286	(27,952,827)
단기금융상품의 순감소(증가)	43,136,356	2,828,417
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	416,095	2,875,410
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(1,509)	(12,622)
장기금융상품의 처분	4,564,561	6,896,413
장기금융상품의 취득	(534)	(4,394,020)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	5,105,980	484,237
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(106,890)	(35,877)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	44,404	162,816
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(101,842)	(107,186)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	24,517	13,233
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(71,875)	(903,758)
유형자산의 처분	68,377	190,522
유형자산의 취득	(42,398,379)	(32,471,328)
무형자산의 처분	11,253	23,462
무형자산의 취득	(2,248,152)	(3,189,459)
사업결합으로 인한 현금유출액	0	(31,383)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(843,076)	(281,704)
재무활동 현금흐름	(8,718,437)	(14,684,755)
단기차입금의 순증가(감소)	(702,893)	(6,233,550)
장기차입금의 차입	234,455	143,471
사채 및 장기차입금의 상환	(871,679)	(1,234,569)
배당금의 지급	(7,369,130)	(7,359,304)
비지배지분의 증감	(9,190)	(803)
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,390,527	4,553,142
현금및현금성자산의 순증감	25,463,574	5,484,006
기초의 현금및현금성자산	49,680,710	39,031,415
기말의 현금및현금성자산	75,144,284	44,515,421

3. 연결재무제표 주석

제 55 기 분기 : 2023년 9월 30일 현재

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항:

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 통신시스템등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 233개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 38개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Emerald Intermediate, Inc.	해외자회사관리	100.0
	Emerald Merger Sub, Inc.	해외자회사관리	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽· CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	디스플레이 패널 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0	
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0	
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	전자제품 판매	100.0	

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	디스플레이 패널 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV·모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	디스플레이 패널 부품 생산	69.0
	지에프(주)	디스플레이 패널 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7	
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5	
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성디스플레이(주)	65,661,187	9,078,807	7,427,496	4,090,757	18,462,908	6,495,536
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	40,047,703	12,794,965	10,216,410	(273,767)	30,193,962	21,005
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	20,083,586	250,086	-	4,109,008	-	11,075,857
Harman과 그 종속기업(*2)	18,348,777	6,442,861	3,791,817	320,808	10,443,291	606,707
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	15,912,171	833,393	1,890,492	205,634	6,901,659	736,368
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	14,362,003	5,098,373	1,080,710	8,389	3,172,155	260,833
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	14,025,240	2,952,097	8,761,281	1,180,774	24,108,238	2,347,215
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,274,733	5,324,411	6,241,452	99,630	16,318,423	282,091
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,352,788	8,941,898	922,821	(28,228)	2,497,085	149,741
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,174,678	4,266,691	-	32,306	-	64,391
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	8,794,437	2,790,114	6,689,888	514,812	16,903,470	1,085,346
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	8,521,472	4,163,287	4,460,246	399,072	11,773,610	967,435
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	8,412,284	1,876,079	6,016,323	711,676	16,050,234	1,621,889
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,424,419	1,523,607	1,864,916	58,195	5,519,363	222,840
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,198,197	843,240	1,642,747	67,493	4,738,599	419,734
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	3,622,874	2,971,623	3,470,620	57,582	10,059,823	172,515
Samsung International, Inc. (SII)	3,327,515	1,022,173	2,060,157	102,369	5,728,487	871,140
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,002,988	575,616	1,100,817	36,409	3,503,091	222,348
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,818,629	2,016,484	1,480,770	(15,082)	4,331,645	57,282
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,773,063	2,206,048	3,884,218	150,578	11,929,548	377,341
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,474,051	1,410,031	959,167	6,318	2,711,330	89,370
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,222,430	1,794,745	426,892	24,497	1,184,659	87,002
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,039,762	1,431,768	1,054,741	8,202	2,934,200	9,655
세메스(주)	2,002,407	500,223	413,797	(42,157)	1,823,533	40,800
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,960,970	1,923,049	1,528,115	(84,348)	4,577,315	(29,366)

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성디스플레이(주)	57,302,567	7,282,718	8,213,859	1,398,412	22,160,710	3,216,249
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	37,883,156	12,258,315	12,359,183	45,974	36,033,127	317,060
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	26,894,611	2,678,285	-	2,758,915	-	5,275,829
Harman과 그 종속기업(*2)	17,102,324	6,380,456	3,624,938	254,602	9,273,731	380,630
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	17,095,000	2,970,835	2,434,290	198,987	7,303,614	520,629
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	15,718,299	2,358,140	8,892,158	601,054	29,444,969	2,535,630
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,830,988	9,764,636	704,105	(63,639)	2,066,037	(31)
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,199,102	5,930,369	10,682,867	(34,109)	34,335,965	41,636
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	10,931,037	1,408,387	7,071,355	513,103	18,811,037	1,441,477
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	10,841,515	6,272,800	-	13,474	-	41,956
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	9,301,017	828,494	957,429	110,611	2,582,724	96,022
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,471,680	1,608,448	7,681,966	502,426	18,496,759	690,117
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	6,772,537	3,571,863	4,840,661	120,690	12,529,590	437,873
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,067,891	2,858,382	4,001,284	116,542	17,056,067	254,800
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,600,508	1,342,517	1,788,054	91,800	5,678,854	160,490
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,732,057	980,448	1,399,640	61,987	4,954,535	389,295
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,263,473	486,820	1,053,853	(18,265)	3,765,015	(12,579)
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,819,792	1,708,064	1,457,404	95,167	4,338,915	90,062
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,377,730	597,044	660,674	16,534	2,081,001	9,873
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	2,374,317	452,628	805,902	54,909	3,011,803	178,411
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,194,975	2,021,491	3,115,212	(516,899)	11,377,395	(216,672)
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,135,132	265,835	353,178	3,011	1,948,930	86,559
세메스(주)	2,065,558	602,323	587,109	18,931	2,053,426	147,832
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1,968,273	1,907,132	1,578,812	69,421	4,765,111	(63,753)
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1,816,895	996,002	804,084	11,334	2,360,402	63,903

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	국내	SVIC 62호 신기술투자조합	설립
		반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	설립
	미주	Samsung Federal, Inc. (SFI)	설립
		Emerald Intermediate, Inc.	설립
		Emerald Merger Sub, Inc.	설립
연결제외	미주	Dacor Holdings, Inc.	합병
		Dacor, Inc.	합병
	유럽·CIS	Red Bend Software Ltd.	청산
		Harman Automotive UK Limited	청산

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2023년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2023년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	75,144,284	-	-	-	75,144,284
단기금융상품	17,927,266	-	-	-	17,927,266
단기상각후원가금융자산	-	-	-	-	-
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	31,340	-	31,340
매출채권	43,405,955	-	-	-	43,405,955
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	8,847,905	-	-	8,847,905
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,513,696	-	1,513,696
기타	10,681,724	-	706,440	64,449	11,452,613
계	147,159,229	8,847,905	2,251,476	64,449	158,323,059

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,157,077	-	-	13,157,077
단기차입금	361,873	-	3,980,310	4,342,183
미지급금	12,338,596	-	-	12,338,596
유동성장기부채	281,801	-	993,468	1,275,269
사채	567,683	-	-	567,683
장기차입금	34,396	-	3,830,507	3,864,903
장기미지급금	4,994,752	-	-	4,994,752
기타	11,038,163	273,209	23,454	11,334,826
계	42,774,341	273,209	8,827,739	51,875,289

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	49,680,710	-	-	-	49,680,710
단기금융상품	65,102,886	-	-	-	65,102,886
단기상각후원가금융자산	414,610	-	-	-	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,080	-	29,080
매출채권	35,721,563	-	-	-	35,721,563
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,397,012	-	-	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,405,468	-	1,405,468
기타	9,945,209	-	334,263	61,404	10,340,876
계	160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	10,644,686	-	-	10,644,686
단기차입금	1,577,958	-	3,569,357	5,147,315
미지급금	16,328,237	-	-	16,328,237
유동성장기부채	215,143	-	874,019	1,089,162
사채	536,093	-	-	536,093
장기차입금	33,846	-	3,526,826	3,560,672
장기미지급금	2,289,236	-	-	2,289,236
기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529
계	43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
비유동항목:		
지분상품	8,847,905	11,397,012

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
유동항목:		
채무상품	31,340	29,080
비유동항목:		
지분상품	849,931	773,063
채무상품	663,765	632,405
소 계	1,513,696	1,405,468
계	1,545,036	1,434,548

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	134,027,281	15.2	932,158	1,050,774	684,879
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	169,800	166,592
(주)아이마켓코리아	647,320	1.9	324	5,735	6,538
(주)에스에프에이	2,100,000	5.8	22,050	66,570	132,642
(주)원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	11,224	11,945
(주)원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	118,460	91,621
ASML Holding N.V.	1,580,407	0.4	91,097	1,256,240	4,287,121
Wacom Co., Ltd.	8,398,400	5.3	62,013	44,933	46,750
Corning Incorporated	80,000,000	9.4	3,980,636	3,278,084	3,238,205
기타			607,643	932,724	855,452
계			5,773,127	6,934,544	9,521,745

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	19,115,243	(2,108,729)	17,006,514	17,526,178	(1,493,952)	16,032,226
반제품 및 재공품	27,165,172	(4,278,935)	22,886,237	21,612,965	(1,535,446)	20,077,519
원재료 및 저장품	15,044,237	(1,102,676)	13,941,561	16,268,974	(1,289,694)	14,979,280
미착품	1,421,645	-	1,421,645	1,098,841	-	1,098,841
계	62,746,297	(7,490,340)	55,255,957	56,506,958	(4,319,092)	52,187,866

6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	10,893,869	8,932,251
취득	71,875	1,002,798
처분	(24,517)	(13,213)
이익 중 지분해당액	676,459	804,552
기타(*)	16,067	126,386
분기말	11,633,753	10,852,774

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기㈜	359,237	1,846,072	1,846,626	359,237	1,765,507	1,764,249
삼성에스디에스㈜	147,963	1,947,423	1,960,455	147,963	1,857,481	1,870,338
삼성바이오로직스㈜	1,424,358	2,979,837	2,984,395	1,424,358	2,804,547	2,808,673
삼성SDI㈜	1,242,605	3,678,186	2,912,438	1,242,605	3,318,875	2,691,223
㈜제일기획	506,162	369,807	670,307	506,162	347,510	649,161
기타	692,613	815,164	1,053,298	645,255	718,801	907,333
계	4,372,938	11,636,489	11,427,519	4,325,580	10,812,721	10,690,977

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	135,823	135,841	215,000	137,727	137,745
기타	259,994	71,522	70,393	259,994	67,632	65,147
계	474,994	207,345	206,234	474,994	205,359	202,892

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기와 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,764,249	93,372	26,161	(37,156)	1,846,626
삼성에스디에스(주)	1,870,338	124,751	21,276	(55,910)	1,960,455
삼성바이오로직스(주)	2,808,673	177,431	(1,709)	-	2,984,395
삼성SDI(주)	2,691,223	179,930	55,152	(13,867)	2,912,438
(주)제일기획	649,161	48,624	5,916	(33,394)	670,307
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	137,745	(1,904)	-	-	135,841
기타	972,480	54,255	39,003	57,953	1,123,691
계	10,893,869	676,459	145,799	(82,374)	11,633,753

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,556,386	209,207	56,776	(37,156)	1,785,213
삼성에스디에스(주)	1,652,155	187,413	61,890	(41,933)	1,859,525
삼성바이오로직스(주)	1,577,664	135,156	(1,585)	981,164	2,692,399
삼성SDI(주)	2,529,650	162,798	46,076	(13,462)	2,725,062
(주)제일기획	621,292	48,433	19,964	(28,747)	660,942
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	135,580	3,707	-	-	139,287
기타	859,524	57,838	(11,983)	84,967	990,346
계	8,932,251	804,552	171,138	944,833	10,852,774

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당분기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	5,133,897	8,083,685	5,426,433	9,879,255	2,242,564
비유동자산	6,362,165	4,034,830	10,461,238	23,667,504	550,944
유동부채	2,809,948	2,212,675	4,107,626	9,091,773	1,295,483
비유동부채	622,810	972,685	2,234,024	5,230,970	196,353
비지배지분	180,810	311,785	-	953,501	11,839
요약 포괄손익계산서:					
매출	6,603,526	9,899,748	2,621,080	17,143,535	2,991,311
분기순손익(*)	402,432	551,507	567,008	1,512,989	169,611
기타포괄손익(*)	127,738	94,190	(5,462)	340,547	24,651
총포괄손익(*)	530,170	645,697	561,546	1,853,536	194,262
II. 배당					
배당	37,155	55,911	-	13,867	33,394

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	주제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	4,888,319	8,005,764	6,457,657	9,651,702	2,193,979
비유동자산	6,108,852	3,946,660	10,124,394	20,605,823	557,466
유동부채	2,525,123	2,493,323	4,181,542	8,006,939	1,335,643
비유동부채	778,563	992,132	3,416,034	5,033,084	194,373
비지배지분	154,991	243,777	-	731,779	9,388
요약 포괄손익계산서(전분기):					
매출	7,472,847	12,984,754	2,035,768	14,158,161	3,049,036
분기순손익	872,836	855,889	428,147	1,350,834	168,926
기타포괄손익	250,317	273,990	3,028	352,074	69,117
총포괄손익	1,123,153	1,129,879	431,175	1,702,908	238,043
II. 배당(전분기)					
배당	37,155	41,933	-	13,463	28,748

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	111,979	170,103
비유동자산	185,884	125,507
유동부채	24,303	19,794
비유동부채	1,915	363
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	80,203	103,470
분기순손익	(3,808)	7,414
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(3,808)	7,414
II. 배당		
배당	-	-

(*) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 포괄손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	52,375	1,880	56,407	1,431
기타포괄손익	39,244	(241)	(13,944)	1,961
총포괄손익	91,619	1,639	42,463	3,392

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기(주)	17,693,084	2,431,030	2,308,947
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,362,229	2,149,070
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	15,129,987	18,240,411
삼성SDI(주)	13,462,673	6,892,889	7,956,440
(주)제일기획	29,038,075	582,213	669,328

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주식 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력 정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력 정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당분기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	168,045,388	149,928,539
일반취득 및 자본적지출	38,286,686	34,101,431
감가상각	(26,469,065)	(27,108,961)
처분·폐기·손상	(265,236)	(214,398)
기타(*)	1,208,190	3,636,957
분기말장부금액	180,805,963	160,343,568

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	23,577,699	24,386,804
판매비와관리비 등	2,891,366	2,722,157
계	26,469,065	27,108,961

다. 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 5,578,386백만원(전기말: 4,917,609백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 1,586,885백만원(전분기: 1,138,231백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 902,719백만원(전분기: 841,746백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	20,217,754	20,236,244
개별 취득	4,695,885	2,278,401
상각	(2,363,112)	(2,349,640)
처분·폐기·손상(환입)	(37,095)	(43,768)
기타(*)	623,568	1,363,620
분기말장부금액	23,137,000	21,484,857

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 사업결합으로 인한 취득 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	1,661,406	1,642,460
판매비와관리비 등	701,706	707,180
계	2,363,112	2,349,640

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.1~17.0	3,980,310	3,569,357
무담보차입금	씨티은행 등	0.1~62.2	361,873	1,577,958
계			4,342,183	5,147,315
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP 등	36.1~61.5	281,801	208,915
리스부채(*2)	CSSD 등	4.2	993,468	874,019
계			1,275,269	1,082,934
장기차입금:				
은행차입금	기업은행 등	2.2~7.1	34,396	33,846
리스부채(*2)	CSSD 등	4.2	3,830,507	3,526,826
계			3,864,903	3,560,672

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 144,529백만원(전분기: 95,694백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	26,896 (US\$ 20,000천)	31,683 (US\$ 25,000천)
US\$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.05.11	2025.05.15	4.2	537,920 (US\$ 400,000천)	506,920 (US\$ 400,000천)
소 계				564,816	538,603
사채할인발행차금				(427)	(543)
사채할증발행차금				3,294	4,261
계				567,683	542,321
차감: 유동성사채				-	(6,228)
비유동성사채				567,683	536,093

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	14,455,898	13,639,460
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	280,533	370,848
소 계	14,736,431	14,010,308
사외적립자산의 공정가치	(19,139,365)	(19,593,910)
순확정급여부채(자산) 계	(4,402,934)	(5,583,602)

나. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	961,884	1,030,430
순이자원가(수익)	(263,823)	(73,583)
과거근무원가	(609)	(116)
기타	14,414	2,580
계	711,866	959,311

다. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	281,444	409,956
판매비와관리비 등	430,422	549,355
계	711,866	959,311

12. 충당부채:

당분기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	2,309,726	1,546,606	783,263	3,133,830	7,773,425
순전입(환입)	1,828,541	442,433	389,970	2,253,061	4,914,005
사용	(1,684,846)	(277,454)	(259,241)	(913,653)	(3,135,194)
기타(*)	72,026	73,257	9,453	41,791	196,527
당분기말	2,525,447	1,784,842	923,445	4,515,029	9,748,763

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO₂-eq))

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,761
배출량 추정치	1,861

(2) 당분기 및 전분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	19,567	46,074
증가	1,272	1,871
사용	(17,702)	(28,379)
당분기말	3,137	19,566

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	32,838	45,049
순전입(환입)	(15,212)	16,246
사용	(17,491)	(28,378)
당분기말	135	32,917

13. 우발부채와 약정사항:

가. 소송 등

당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 기타 약정사항

당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 12,074,732백만원입니다.

14. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	13,344,308	13,255,682

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	208,026,544	192,294,496
연결미처분이익잉여금	134,098,875	145,651,911
계	342,125,419	337,946,407

나. 당분기 및 전분기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2023년과 2022년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당분기	전분기	
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	796,929	2,749,109
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	258,899	114,987
해외사업장환산외환차이	7,552,947	1,039,197
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,441,482)	(2,051,610)
기타	86,067	86,645
계	6,253,360	1,938,328

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(630,592)	(3,783,006)	(3,967,208)	(10,966,180)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	26,445,655	74,832,914	30,179,496	87,110,903
급여	6,920,360	22,911,999	7,609,761	22,870,748
퇴직급여	276,350	827,860	347,817	1,040,241
감가상각비	8,900,426	26,469,065	9,031,116	27,108,961
무형자산상각비	786,661	2,363,112	806,611	2,349,640
복리후생비	1,538,580	4,820,029	1,493,425	4,634,290
유틸리티비	1,930,649	5,563,137	1,585,043	4,367,069
외주용역비	1,760,398	5,171,254	1,588,523	4,723,531
광고선전비	1,684,283	3,903,065	1,779,403	4,644,584
판매촉진비	1,831,205	5,072,992	2,012,484	5,372,838
기타비용	13,527,143	39,260,876	13,463,164	39,439,661
계(*)	64,971,118	187,413,297	65,929,635	192,696,286

(*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	2,041,225	6,215,701	1,979,566	5,859,384
퇴직급여	67,982	208,139	76,880	226,880
지급수수료	2,090,579	6,265,157	1,575,095	5,112,393
감가상각비	414,681	1,237,680	404,849	1,166,292
무형자산상각비	173,252	514,838	164,713	496,410
광고선전비	1,684,283	3,903,065	1,779,403	4,644,584
판매촉진비	1,831,205	5,072,992	2,012,484	5,372,838
운반비	397,097	1,231,700	869,016	2,710,734
서비스비	1,129,564	3,239,695	1,149,249	2,879,811
기타판매비와관리비	1,509,981	4,461,489	1,576,562	4,366,231
소계	11,339,849	32,350,456	11,587,817	32,835,557
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	7,012,543	20,789,832	6,269,581	18,446,687
계	18,352,392	53,140,288	17,857,398	51,282,244

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익:				
배당금수익	34,490	131,278	42,619	373,528
임대료수익	37,383	112,288	35,511	105,009
유형자산처분이익	28,003	83,050	21,740	135,940
기타	144,476	623,207	216,314	865,871
계	244,352	949,823	316,184	1,480,348
(2) 기타비용:				
유형자산처분손실	50,034	70,037	10,691	34,798
기부금	76,808	179,601	47,506	222,932
기타	79,561	329,804	225,337	1,079,307
계	206,403	579,442	283,534	1,337,037

21. 금융수익 및 금융비용:

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익:				
이자수익	1,145,777	3,358,496	799,442	1,655,668
- 상각후원가 측정 금융자산	1,145,726	3,358,318	799,381	1,655,478
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	51	178	61	190
외환차이	2,540,874	8,419,489	5,556,898	12,656,305
파생상품관련이익	425,507	1,019,150	402,632	1,321,073
계	4,112,158	12,797,135	6,758,972	15,633,046
(2) 금융비용:				
이자비용	279,290	857,860	216,463	488,758
- 상각후원가 측정 금융부채	159,815	487,721	101,726	208,293
- 기타금융부채	119,475	370,139	114,737	280,465
외환차이	2,455,110	8,387,347	5,474,346	12,610,603
파생상품관련손실	169,317	859,051	410,746	1,166,491
계	2,903,717	10,104,258	6,101,555	14,265,852

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 (-)22.2%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	5,501,304	8,449,574	9,143,900	31,227,509
분기순이익 중 보통주 해당분	4,834,858	7,425,965	8,036,177	27,444,504
÷가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	810	1,244	1,346	4,597

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	5,501,304	8,449,574	9,143,900	31,227,509
분기순이익 중 우선주 해당분	666,446	1,023,609	1,107,723	3,783,005
÷가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	810	1,244	1,346	4,597

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용(수익)	(1,660,366)	9,572,925
금융수익	(5,173,514)	(5,720,068)
금융비용	3,067,746	5,011,592
퇴직급여	827,860	1,040,241
감가상각비	26,469,065	27,108,961
무형자산상각비	2,363,112	2,349,640
대손상각비	91,444	39,755
배당금수익	(131,278)	(373,528)
지분법이익	(676,459)	(804,552)
유형자산처분이익	(83,050)	(135,940)
유형자산처분손실	70,037	34,798
재고자산평가손실 등	4,919,360	3,336,120
기타	27,100	175,011
계	30,111,057	41,634,955

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(5,734,362)	1,957,951
미수금의 감소(증가)	990,596	(846,896)
장단기선급비용의 감소(증가)	(377,419)	(484,023)
재고자산의 감소(증가)	(6,286,040)	(14,612,657)
매입채무의 증가(감소)	1,380,348	(4,079,647)
장단기미지급금의 증가(감소)	637,296	(1,966,307)
선수금의 증가(감소)	58,239	(63,920)
예수금의 증가(감소)	(540,655)	(435,965)
미지급비용의 증가(감소)	(4,137,776)	287,421
장단기충당부채의 증가(감소)	1,778,811	69,566
퇴직금의 지급	(536,633)	(458,197)
기타	(165,738)	(1,206,401)
계	(12,933,333)	(21,839,075)

나. 당분기 및 전분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 814,987백만원 및 739,313백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 144,529백만원 및 95,694백만원입니다.

25. 재무위험관리:

연결회사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있습니다. 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

연결회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화 하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 방향으로 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다.

(3) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 65,826백만원(전분기: 88,571백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 3,519백만원(전분기: 3,170백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보 제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

연결회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

라. 자본위험

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 연결회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	90,573,804	93,674,903
자 본	363,892,643	354,749,604
부채비율	24.9%	26.4%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	75,144,284	(*1)	49,680,710	(*1)
단기금융상품	17,927,266	(*1)	65,102,886	(*1)
단기상각후원가금융자산	-	(*1)	414,610	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	31,340	31,340	29,080	29,080
매출채권	43,405,955	(*1)	35,721,563	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,847,905	8,847,905	11,397,012	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	1,513,696	1,513,696	1,405,468	1,405,468
기타(*2)	11,452,613	770,889	10,340,876	395,667
계	158,323,059		174,092,205	
금융부채:				
매입채무	13,157,077	(*1)	10,644,686	(*1)
단기차입금	4,342,183	(*1)	5,147,315	(*1)
미지급금	12,338,596	(*1)	16,328,237	(*1)
유동성장기부채	1,275,269	-	1,089,162	6,580
- 유동성장기차입금	1,275,269	(*1)(*3)	1,082,934	(*1)(*3)
- 유동성사채	-	-	6,228	6,580
사채	567,683	554,372	536,093	521,129
장기차입금	3,864,903	(*1)(*3)	3,560,672	(*1)(*3)
장기미지급금	4,994,752	(*1)	2,289,236	(*1)
기타(*2)	11,334,826	296,663	12,409,529	361,768
계	51,875,289		52,004,930	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,681,724백만원(전기말: 9,945,209백만원)

및 금융부채 11,038,163백만원(전기말: 12,047,761백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	31,340	-	31,340
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,582,634	-	2,265,271	8,847,905
당기손익-공정가치금융자산	351,910	-	1,161,786	1,513,696
기타	-	372,718	398,171	770,889
금융부채:				
유동성사채	-	-	-	-
사채	-	554,372	-	554,372
기타	-	295,143	1,520	296,663

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,080	-	29,080
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,207,295	-	2,189,717	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	314,449	-	1,091,019	1,405,468
기타	-	373,176	22,491	395,667
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	521,129	-	521,129
기타	-	354,364	7,404	361,768

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	31,245	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	18.5%
(주)미코세라믹스	32,191	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	15.5%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,297,590	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.4%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	215,156	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.4%
기타:				
지분 콜옵션	376,755	이항모형	무위험 이자율	3.9%
			가격 변동성	69.4%
지분 풋옵션	21,416	이항모형	무위험 이자율	4.7%~5.5%, 2.3%
			가격 변동성	22.8%, 27.5%

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	3,303,227	3,430,214
매입	170,913	155,514
매도	(80,013)	(167,601)
당기손익으로 인식된 손익	367,233	77,092
기타포괄손익으로 인식된 손익	41,452	89,067
기타	22,416	63,853
분기말	3,825,228	3,648,139

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	7,404	5,438
기타	(5,884)	-
분기말	1,520	5,438

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	132,922	-	(92,531)
기타(*2)	101,924	-	(93,761)	-

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(5% 또는 10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부 거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	내부거래 조정 등	계(*)
매출액	44,015,400	16,438,381	8,218,580	3,802,481	(5,070,190)	67,404,652
감가상각비	630,205	7,348,081	789,196	84,909	-	8,900,426
무형자산상각비	434,536	186,394	55,773	52,523	-	786,661
영업이익(손실)	3,728,081	(3,753,932)	1,935,165	450,247	-	2,433,534

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	계(*)
매출액	7,318,422	29,248,961	10,530,033	8,218,580	67,404,652

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	내부거래 조정 등	계(*)
매출액	130,444,087	44,902,120	21,315,797	10,464,123	(15,970,571)	191,155,556
감가상각비	1,886,122	21,759,591	2,426,796	247,977	-	26,469,065
무형자산상각비	1,285,032	585,578	166,420	152,204	-	2,363,112
영업이익(손실)	11,766,221	(12,697,630)	3,554,250	830,577	-	3,742,259

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당분기(누적) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	계(*)
매출액	21,999,115	84,602,205	28,414,389	21,315,797	191,155,556

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	내부거래 조정 등	계(*)
매출액	47,257,269	23,023,397	9,394,448	3,625,723	(6,519,157)	76,781,680
감가상각비	651,419	7,152,030	1,129,338	86,312	-	9,031,116
무형자산상각비	440,257	199,632	59,732	51,549	-	806,611
영업이익	3,531,451	5,115,245	1,977,787	311,750	-	10,852,045

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	계(*)
매출액	7,864,136	30,915,091	15,231,542	9,394,448	76,781,680

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	내부거래 조정 등	계(*)
매출액	139,781,307	78,388,379	25,075,619	9,274,903	(20,753,423)	231,766,785
감가상각비	1,866,576	21,087,859	3,813,352	245,005	-	27,108,961
무형자산상각비	1,237,032	611,814	178,913	159,226	-	2,349,644
영업이익	11,108,609	23,546,429	4,128,294	514,952	-	39,070,499

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	TV, 모니터 등	스마트폰 등	메모리	디스플레이 패널	계(*)
매출액	24,119,971	90,143,332	56,398,363	25,075,619	231,766,785

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소채지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	12,422,555	24,194,051	11,730,385	11,797,052	7,260,609	-	67,404,652
비유동자산(*)	158,137,126	17,953,693	6,136,716	9,276,504	13,306,785	(867,861)	203,942,963

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	33,992,795	68,278,463	35,377,963	34,344,380	19,161,955	-	191,155,556
비유동자산(*)	158,137,126	17,953,693	6,136,716	9,276,504	13,306,785	(867,861)	203,942,963

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	13,591,271	30,407,379	12,449,033	12,929,465	7,404,532	-	76,781,680
비유동자산(*)	135,273,659	13,671,615	6,109,337	10,228,393	17,468,718	(923,297)	181,828,425

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
매출액	36,927,076	91,981,151	36,793,435	37,842,883	28,222,240	-	231,766,785
비유동자산(*)	135,273,659	13,671,615	6,109,337	10,228,393	17,468,718	(923,297)	181,828,425

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	120,809	-	1,481,041	219,924
	삼성전기(주)	61,381	-	860,130	60
	삼성SDI(주)	90,332	-	555,308	21,037
	(주)제일기획	37,183	-	638,490	1,162
	기타	697,346	-	9,302,277	119,468
	관계기업 및 공동기업 계	1,007,051	-	12,837,246	361,651
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	41,776	70	196,312	3,907,737
	기타	378,253	-	1,324,851	2,952,677
	그 밖의 특수관계자 계	420,029	70	1,521,163	6,860,414
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	1,055	-	23,919	1,922,259
	(주)에스원	7,493	-	391,091	28,792
	기타	167,119	-	887,932	302,680
	기타 계	175,667	-	1,302,942	2,253,731

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	179,357	-	1,335,563	280,663
	삼성전기(주)	55,175	767	1,109,944	-
	삼성SDI(주)	66,595	-	599,596	23,187
	(주)제일기획	30,993	-	722,128	361
	기타	962,526	-	10,974,089	82,186
	관계기업 및 공동기업 계	1,294,646	767	14,741,320	386,396
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	40,325	-	304,761	4,778,370
	기타	266,133	-	1,214,781	919,010
	그 밖의 특수관계자 계	306,458	-	1,519,542	5,697,380
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	1,285	-	29,111	1,802,523
	(주)에스원	8,224	-	375,659	23,348
	기타	123,180	-	451,679	315,588
	기타 계	132,689	-	856,449	2,141,459

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 채권·채무 등 잔액

보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	23,151	492,395
	삼성전기(주)	1,721	130,520
	삼성SDI(주)	125,563	85,248
	(주)제일기획	167	326,684
	기타	252,861	1,216,914
	관계기업 및 공동기업 계	403,463	2,251,761
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	214,588	937,827
	기타	22,402	250,818
	그 밖의 특수관계자 계	236,990	1,188,645
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	127	320,478
	(주)에스원	1,144	50,650
	기타	14,885	412,073
	기타 계	16,156	783,201

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	49,792	512,022
	삼성전기(주)	385	133,952
	삼성SDI(주)	121,605	92,452
	(주)제일기획	223	453,545
	기타	371,575	1,236,016
	관계기업 및 공동기업 계	543,580	2,427,987
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	217,818	2,783,240
	기타	20,830	250,103
	그 밖의 특수관계자 계	238,648	3,033,343
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	331	1,251,039
	(주)에스원	3,839	73,102
	기타	15,647	545,684
	기타 계	19,817	1,869,825

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 71,875백만원 및 903,758백만원을 출자하였습니다. 또한 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 24,517백만원 및 13,087백만원의 출자원금을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,238,585백만원 및 1,249,916백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 96,174백만원 및 96,174백만원입니다. 당분기 말 및 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자와 체결한 리스계약은 1,812백만원 및 48백만원이며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 18,860백만원 및 18,964백만원입니다.

바. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기	전분기
단기급여	7,737	7,236
퇴직급여	418	451
기타 장기급여	5,876	5,434

28. 보고기간후 사건

연결회사의 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Micro Display 경쟁력 강화를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation의 지분 100%를 총 295,291백만원에 인수하였습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 55 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 54 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기말	제 54 기말
자산		
유동자산	74,844,254	59,062,658
현금및현금성자산	10,539,545	3,921,593
단기금융상품	1,268	137
매출채권	26,809,541	20,503,223
미수금	1,701,439	2,925,006
선급비용	1,141,136	1,047,900
재고자산	32,102,177	27,990,007
기타유동자산	2,549,148	2,674,792
비유동자산	219,646,193	201,021,092
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,853,221	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	1	283
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,356,927	57,397,249
유형자산	134,588,738	123,266,986
무형자산	10,843,890	8,561,424
순확정급여자산	3,405,473	4,410,223
이연법인세자산	7,378,063	2,142,512
기타비유동자산	4,219,880	3,878,090
자산총계	294,490,447	260,083,750
부채		
유동부채	38,156,918	46,086,047
매입채무	11,063,841	8,729,315
단기차입금	2,432,738	2,381,512
미지급금	11,332,845	18,554,543
선수금	243,410	320,689
예수금	417,712	523,354
미지급비용	6,912,178	8,359,296
당기법인세부채	0	2,533,481
유동성장기부채	219,208	135,753
총당부채	5,036,684	4,059,491
기타유동부채	498,302	488,613
비유동부채	30,125,495	4,581,512
사채	26,469	24,912
장기차입금	22,931,438	654,979

장기미지급금	4,887,238	2,439,232
장기총당부채	2,248,227	1,423,165
기타비유동부채	32,123	39,224
부채총계	68,282,413	50,667,559
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	221,190,271	204,388,016
기타자본항목	(283,644)	(273,232)
자본총계	226,208,034	209,416,191
부채와자본총계	294,490,447	260,083,750

4-2. 손익계산서

손익계산서

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기		제 54 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	45,866,224	127,763,991	53,711,041	169,076,587
매출원가	38,570,371	109,492,430	38,689,379	117,838,559
매출총이익	7,295,853	18,271,561	15,021,662	51,238,028
판매비와관리비	9,463,841	28,046,413	8,591,606	25,497,263
영업이익	(2,167,988)	(9,774,852)	6,430,056	25,740,765
기타수익	7,368,532	29,471,874	133,133	560,801
기타비용	118,180	249,611	50,733	204,518
금융수익	2,080,064	6,062,738	3,400,924	7,629,962
금융비용	2,060,513	6,537,513	3,372,472	7,247,977
법인세차감전순이익	5,101,915	18,972,636	6,540,908	26,479,033
법인세비용(수익)	(5,314,896)	(5,186,903)	792,430	4,887,304
계속영업이익(손실)	10,416,811	24,159,539	5,748,478	21,591,729
당기순이익(손실)	10,416,811	24,159,539	5,748,478	21,591,729
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,534	3,557	846	3,179
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,534	3,557	846	3,179

4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기		제 54 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	10,416,811	24,159,539	5,748,478	21,591,729
기타포괄손익	54,584	(10,413)	(165,065)	(382,471)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	54,584	(10,413)	(165,065)	(382,471)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	89,732	359,844	(126,936)	(242,569)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(35,148)	(370,257)	(38,129)	(139,902)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
총포괄손익	10,471,395	24,149,126	5,583,413	21,209,258

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익(손실)			21,591,729		21,591,729
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(3,332)	(239,237)	(242,569)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(139,902)	(139,902)
배당			7,357,284		7,357,284
2022.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	203,005,448	(1,261,149)	207,045,706
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191
당기순이익(손실)			24,159,539		24,159,539
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				359,844	359,844
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(370,257)	(370,257)
배당			7,357,283		7,357,283
2023.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	221,190,272	(283,645)	226,208,034

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 55 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 55 기 3분기	제 54 기 3분기
영업활동 현금흐름	27,503,092	32,668,076
영업에서 창출된 현금흐름	817,658	39,316,849
당기순이익	24,159,539	21,591,729
조정	(8,050,695)	27,324,053
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,291,186)	(9,598,933)
이자의 수취	238,470	253,051
이자의 지급	(465,207)	(210,740)
배당금 수입	29,490,565	164,436
법인세 납부액	(2,578,394)	(6,855,520)
투자활동 현금흐름	(35,415,842)	(16,951,015)
단기금융상품의 순감소(증가)	(1,131)	12,696,070
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	22	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	243	1,744
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	125,402	165,085
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(85,106)	(987,160)
유형자산의 처분	134,435	260,949
유형자산의 취득	(33,487,072)	(26,103,575)
무형자산의 처분	11,397	5,457
무형자산의 취득	(2,040,397)	(2,885,624)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(73,635)	(103,961)
재무활동 현금흐름	14,541,236	(12,674,014)
단기차입금의 순증가(감소)	45,578	(5,202,854)
장기차입금의 차입	21,990,000	
사채 및 장기차입금의 상환	(136,145)	(114,056)
배당금의 지급	(7,358,197)	(7,357,104)
외화환산으로 인한 현금의 변동	(10,534)	3,276
현금및현금성자산의 순증감	6,617,952	3,046,323
기초의 현금및현금성자산	3,921,593	3,918,872
기말의 현금및현금성자산	10,539,545	6,965,195

5. 재무제표 주석

제 55 기 분기 : 2023년 9월 30일 현재

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2023년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2023년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	10,539,545	-	-	10,539,545
단기금융상품	1,268	-	-	1,268
매출채권	26,809,541	-	-	26,809,541
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,853,221	-	1,853,221
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1	1
기타	4,664,655	-	376,755	5,041,410
계	42,015,009	1,853,221	376,756	44,244,986

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,063,841	-	11,063,841
단기차입금	-	2,432,738	2,432,738
미지급금	11,097,651	-	11,097,651
유동성장기부채	-	219,208	219,208
사채	26,469	-	26,469
장기차입금	21,990,000	941,438	22,931,438
장기미지급금	4,526,352	-	4,526,352
기타	3,803,648	-	3,803,648
계	52,507,961	3,593,384	56,101,345

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,921,593	-	-	3,921,593
단기금융상품	137	-	-	137
매출채권	20,503,223	-	-	20,503,223
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,364,325	-	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	-	-	283	283
기타	5,470,355	-	-	5,470,355
계	29,895,308	1,364,325	283	31,259,916

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	8,729,315	-	8,729,315
단기차입금	-	2,381,512	2,381,512
미지급금	18,324,604	-	18,324,604
유동성장기부채	6,228	129,525	135,753
사채	24,912	-	24,912
장기차입금	-	654,979	654,979
장기미지급금	2,083,790	-	2,083,790
기타	3,145,473	-	3,145,473
계	32,314,322	3,166,016	35,480,338

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	1,853,221	1,364,325

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
채무상품	1	283

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	134,027,281	15.2	932,158	1,050,774	684,879
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	169,800	166,592
(주)아이마켓코리아	647,320	1.9	324	5,735	6,538
(주)케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	1,438	1,954
(주)용평리조트	400,000	0.8	1,869	1,196	1,412
(주)에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	17,082	12,879
(주)원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	5,612	5,972
(주)원익아이피에스	1,850,936	3.8	16,214	59,230	45,811
(주)동진세미켐	2,467,894	4.8	48,277	82,921	73,913
솔브레인홀딩스(주)	461,741	2.2	30,752	13,460	10,989
솔브레인(주)	373,368	4.8	24,866	85,688	81,357
(주)에스앤에스텍	1,716,116	8.0	65,933	75,595	45,220
와이아이케이(주)	9,601,617	11.7	47,336	35,910	26,933
(주)케이씨텍	1,022,216	4.9	20,720	22,233	15,129
(주)엘오티베콤	1,267,668	7.1	18,990	36,890	14,326
(주)뉴파워프라즈마	2,140,939	4.9	12,739	11,946	7,579
(주)에프에스티	1,522,975	7.0	43,009	30,353	23,758
(주)디엔에프	810,030	7.0	20,964	13,949	10,692
Marvell	173,187	0.0	11,705	12,607	8,129
SoundHound AI, Inc.	1,702,957	0.9	13,719	4,602	3,820
계			1,368,634	1,737,021	1,247,882

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	10,033,607	(1,778,134)	8,255,473	8,589,879	(956,427)	7,633,452
반제품 및 재공품	22,885,166	(3,854,809)	19,030,357	16,738,121	(1,216,059)	15,522,062
원재료 및 저장품	4,687,296	(454,965)	4,232,331	4,891,951	(492,006)	4,399,945
미착품	584,016	-	584,016	434,548	-	434,548
계	38,190,085	(6,087,908)	32,102,177	30,654,499	(2,664,492)	27,990,007

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	57,397,249	56,225,599
취득	85,106	1,257,733
처분	(125,428)	(164,503)
분기말장부금액	57,356,927	57,318,829

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.
(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	2,431,030	445,244	2,308,947	445,244
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,362,229	560,827	2,149,070	560,827
삼성바이오로직스(주)	22,217,309	15,129,987	1,595,892	18,240,411	1,595,892
삼성SDI(주)	13,462,673	6,892,889	1,242,605	7,956,440	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	582,213	491,599	669,328	491,599

7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	123,266,986	103,667,025
일반취득 및 자본적지출	30,375,856	27,525,141
감가상각	(18,935,711)	(18,179,048)
처분·폐기·손상	(116,364)	(171,907)
기타	(2,029)	105,103
분기말장부금액	134,588,738	112,946,314

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	17,449,986	16,828,439
판매비와관리비 등	1,485,725	1,350,609
계	18,935,711	18,179,048

다. 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 1,884,627백만원(전기말: 1,236,013백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 846,906백만원(전분기: 443,457백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 177,516백만원(전분기: 121,224백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	8,561,424	8,657,456
개별 취득	4,275,619	2,191,981
상각	(1,974,390)	(1,935,703)
처분·폐기·손상	(36,598)	(33,487)
기타	17,835	3,732
분기말장부금액	10,843,890	8,883,979

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	1,525,100	1,487,617
판매비와관리비 등	449,290	448,086
계	1,974,390	1,935,703

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	만기일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
단기차입금:					
담보부차입금(*1)	우리은행 등	-	0.2~17.0	2,432,738	2,381,512
유동성장기차입금:					
리스부채(*2)	-	-	2.7	219,208	129,525
장기차입금:					
리스부채(*2)	-	-	2.7	941,438	654,979
무담보차입금	삼성디스플레이(주)	2025.08.16	4.6	21,990,000	-
계				22,931,438	654,979

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은 20,045백만원(전분기: 7,215백만원)입니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	26,896 (US\$ 20,000천)	31,683 (US\$ 25,000천)
사채할인발행차금				(427)	(543)
계				26,469	31,140
차감: 유동성사채				-	(6,228)
비유동성사채				26,469	24,912

(*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	11,560,824	10,729,126
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	31,837	29,546
소계	11,592,661	10,758,672
사외적립자산의 공정가치	(14,998,134)	(15,168,895)
순확정급여부채(자산) 계	(3,405,473)	(4,410,223)

나. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	721,775	772,525
순이자원가(수익)	(206,435)	(68,926)
계	515,340	703,599

다. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	202,355	280,316
판매비와관리비 등	312,985	423,283
계	515,340	703,599

12. 충당부채:

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	587,665	1,546,606	549,181	2,799,204	5,482,656
순전입(환입)	653,555	425,856	300,238	2,226,182	3,605,831
사용	(545,751)	(277,454)	(183,843)	(907,299)	(1,914,347)
기타	-	73,256	-	37,515	110,771
당분기말	695,469	1,768,264	665,576	4,155,602	7,284,911

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO₂-eq))

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,127
배출량 추정치	1,435

(2) 당분기 및 전분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	19,567	46,073
증가	1,265	1,871
사용	(17,695)	(28,378)
분기말	3,137	19,566

(3) 당분기 및 전분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	32,825	45,049
순전입	(15,348)	16,214
사용	(17,477)	(28,378)
분기말	-	32,885

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

(1) 당분기말 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

해외종속기업	보증처	보증종료일	당분기말	
			관련차입금	채무보증한도
SETK	BNP 외	2024-06-13	358,522	1,152,494
SETK-P	BNP 외	2023-12-16	8,361	174,824
기타	기타	-	-	9,586,130
계			366,883 (US\$ 272,824천)	10,913,448 (US\$ 8,115,294천)

(2) 당분기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 492,289백만원입니다.

(3) 당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

나. 소송 등

당분기말 현재 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대책무

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

라. 기타 약정사항

당분기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 8,311,345백만원입니다.

14. 계약부채 :

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	1,544,940	1,133,426

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	220,739,482	203,937,227
계	221,190,271	204,388,016

나. 당분기 및 전분기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당(배당기준일: 2023년과 2022년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당분기	전분기	
1분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	보통주·우선주	361%	361%
	배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
		우선주	297,062	297,062
		계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	237,201	(122,644)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,281,253)	(1,910,996)
기타	1,760,408	1,760,408
계	(283,644)	(273,232)

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	327,935	(4,130,316)	(3,709,441)	(7,856,872)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	24,687,598	71,987,905	28,477,726	84,420,323
급여	2,716,624	10,772,706	3,704,949	11,765,718
퇴직급여	173,803	521,862	236,004	708,653
감가상각비	6,432,818	18,935,711	6,158,860	18,179,048
무형자산상각비	656,866	1,974,390	669,845	1,935,703
복리후생비	778,649	2,445,405	790,951	2,477,034
유틸리티비	1,305,906	3,717,654	988,454	2,656,717
외주용역비	936,144	2,795,393	829,887	2,577,636
광고선전비	643,777	1,299,175	504,889	1,293,752
판매촉진비	252,133	864,804	403,905	1,064,249
기타비용	9,121,959	26,354,154	8,224,956	24,113,861
계(*)	48,034,212	137,538,843	47,280,985	143,335,822

(*) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비:				
급여	591,864	1,976,526	581,848	1,874,153
퇴직급여	31,500	94,104	41,172	123,488
지급수수료	756,087	2,471,999	353,196	1,695,364
감가상각비	119,777	348,326	103,006	302,390
무형자산상각비	98,775	292,024	90,479	269,884
광고선전비	643,777	1,299,175	504,889	1,293,752
판매촉진비	252,133	864,804	403,905	1,064,249
운반비	128,634	399,842	193,845	754,217
서비스비	427,007	1,078,175	456,510	958,052
기타판매비와관리비	571,123	1,650,370	602,154	1,649,081
소 계	3,620,677	10,475,345	3,331,004	9,984,630
(2) 경상연구개발비:				
연구개발 총지출액	5,843,164	17,571,068	5,260,602	15,512,633
계	9,463,841	28,046,413	8,591,606	25,497,263

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익:				
배당금수익	7,246,537	29,092,317	26,597	164,436
임대료수익	46,261	136,660	43,623	129,333
유형자산처분이익	16,261	85,536	11,441	100,133
기타	59,473	157,361	51,472	166,899
계	7,368,532	29,471,874	133,133	560,801
(2) 기타비용:				
유형자산처분손실	41,702	47,040	2,371	6,490
기부금	58,689	136,328	29,204	158,607
기타	17,789	66,243	19,158	39,421
계	118,180	249,611	50,733	204,518

21. 금융수익 및 금융비용:

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익:				
이자수익	129,961	280,542	86,107	255,027
- 상각후원가 측정 금융자산	129,961	280,542	86,107	255,027
외환차이	1,743,306	5,339,646	3,314,817	7,104,362
파생상품관련이익	206,797	442,550	-	270,573
계	2,080,064	6,062,738	3,400,924	7,629,962
(2) 금융비용:				
이자비용	368,665	846,643	88,439	207,535
- 상각후원가 측정 금융부채	299,577	633,049	11,314	35,240
- 기타금융부채	69,088	213,594	77,125	172,295
외환차이	1,691,848	5,597,291	3,284,033	7,040,442
파생상품관련손실	-	93,579	-	-
계	2,060,513	6,537,513	3,372,472	7,247,977

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 (-)27.3%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	10,416,811	24,159,539	5,748,478	21,591,729
분기순이익 중 보통주 해당분	9,154,883	21,232,772	5,052,088	18,976,034
÷ 가중평균유통보통주식수	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(단위 : 원)	1,534	3,557	846	3,179

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	10,416,811	24,159,539	5,748,478	21,591,729
분기순이익 중 우선주 해당분	1,261,928	2,926,767	696,390	2,615,695
÷ 가중평균유통우선주식수	822,887	822,887	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(단위 : 원)	1,534	3,557	846	3,179

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용(수익)	(5,186,903)	4,887,304
금융수익	(1,082,050)	(2,090,102)
금융비용	1,820,509	2,377,160
퇴직급여	521,862	708,653
감가상각비	18,935,711	18,179,048
무형자산상각비	1,974,390	1,935,703
대손상각비(환입)	21,150	11,495
배당금수익	(29,092,317)	(164,436)
유형자산처분이익	(85,536)	(100,133)
유형자산처분손실	47,040	6,490
재고자산평가손실(환입) 등	4,052,533	1,539,781
기타	22,916	33,090
계	(8,050,695)	27,324,053

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(5,895,993)	2,846,827
미수금의 감소(증가)	836,995	(4,581)
장단기선급비용의 증가	(255,602)	(210,486)
재고자산의 증가	(7,678,307)	(11,094,939)
매입채무의 증가	2,201,322	2,367,864
장단기미지급금의 감소	(3,493,328)	(1,606,051)
선수금의 증가(감소)	(77,280)	(86,842)
예수금의 증가(감소)	(105,642)	(184,667)
미지급비용의 감소	(1,741,372)	(285,737)
장단기충당부채의 증가	1,301,987	162,097
퇴직금의 지급	(355,697)	(278,169)
기타	(28,269)	(1,224,249)
계	(15,291,186)	(9,598,933)

나. 당분기 및 전분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 129,808백만원 및 108,129백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 20,045백만원 및 7,215백만원입니다.

25. 재무위험관리:

회사는 영업활동에서 과생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화 외 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있습니다.

회사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시 기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 방향으로 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

(3) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 17,370백만원(전분기: 12,110백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없었던 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가등을 거쳐 시행하고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

회사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성 위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

라. 자본위험

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2023년 3분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	68,282,413	50,667,559
자 본	226,208,034	209,416,191
부채비율	30.2%	24.2%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	10,539,545	(*1)	3,921,593	(*1)
단기금융상품	1,268	(*1)	137	(*1)
매출채권	26,809,541	(*1)	20,503,223	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,853,221	1,853,221	1,364,325	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	1	1	283	283
기타(*2)	5,041,410	376,755	5,470,355	(*1)
계	44,244,986		31,259,916	
금융부채:				
매입채무	11,063,841	(*1)	8,729,315	(*1)
단기차입금	2,432,738	(*1)	2,381,512	(*1)
미지급금	11,097,651	(*1)	18,324,604	(*1)
유동성장기부채	219,208	-	135,753	6,580
- 유동성장기차입금	219,208	(*3)	129,525	(*3)
- 유동성사채	-	-	6,228	6,580
사채	26,469	31,568	24,912	27,845
장기차입금	22,931,438	(*1)(*3)	654,979	(*3)
장기미지급금	4,526,352	(*1)	2,083,790	(*1)
기타	3,803,648	(*1)	3,145,473	(*1)
계	56,101,345		35,480,338	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 4,664,655백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,737,021	-	116,200	1,853,221
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1	1
기타	-	-	376,755	376,755
금융부채:				
유동성사채	-	-	-	-
사채	-	31,568	-	31,568

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,247,882	-	116,443	1,364,325
당기손익-공정가치금융자산	-	-	283	283
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	27,845	-	27,845

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	31,245	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	18.5%
(주)미코세라믹스	32,191	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	15.5%
기타:				
지분 콜옵션	376,755	이항모형	무위험 이자율	3.9%
			가격 변동성	69.4%

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	116,726	120,347
매입	27,784	-
매도	(343)	(5,076)
당기손익으로 인식된 손익	347,859	-
기타포괄손익으로 인식된 손익	930	15,817
기타	-	(13,827)
분기말	492,956	117,261

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	2,717	-	(2,349)
기타(*2)	97,863	-	(89,452)	-

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	30,085,839	16,035,215	45,866,224
감가상각비	132,414	6,249,870	6,432,818
무형자산상각비	424,665	171,897	656,866
영업이익(손실)	2,056,695	(4,225,064)	(2,167,988)

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	84,861,437	43,891,179	127,763,991
감가상각비	402,448	18,382,015	18,935,711
무형자산상각비	1,254,681	542,963	1,974,390
영업이익(손실)	4,313,707	(14,092,471)	(9,774,852)

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	31,505,074	22,738,028	53,711,041
감가상각비	135,626	5,978,393	6,158,860
무형자산상각비	428,343	186,061	669,845
영업이익	1,747,670	4,682,365	6,430,056

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전분기(누적)

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(*)
매출액	93,616,083	77,442,025	169,076,587
감가상각비	407,536	17,642,445	18,179,048
무형자산상각비	1,201,953	571,095	1,935,703
영업이익	3,487,872	22,246,540	25,740,765

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Emerald Intermediate, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Emerald Merger Sub, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽·CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	디스플레이 패널 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0	
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0	
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0	
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0	

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0	
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	디스플레이 패널 부품 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · 디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV·모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체·FPD 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	디스플레이 패널 부품 생산	69.0
	지에프(주)	디스플레이 패널 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5	
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이(주)	216,439	-	1,335,779	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	23,301,646	-	163,818	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	7,246,164	-	18,688	-
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	37,924	-
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	87,599	36,769	6,899,486	11,638
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1,207	106	3,172,155	1,058
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	2,861,458	196	15,973,022	353
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	14,736,063	-	495,258	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	4,543,608	-	7,843	-
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	-	-	-	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	1,075,640	-	-	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	2,660,260	210	3,607,393	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	1,694,382	-	10,727,931	767
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1,037,947	-	13,061	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	404,634	4,054	4,035,135	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	8,531,291	-	-	-
	Samsung International, Inc. (SII)	195,233	51	5,600,812	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1,837,851	-	1,792,890	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1,448,281	-	87,410	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	3,831,916	-	6,794	-
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,084,854	-	5,058	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	83,115	-	-	-
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,563,740	-	891	-
	세메스(주)	5,525	-	1,607,210	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,689,625	-	5,109	-
	기타	40,713,476	3,540	10,002,227	2,164
	종속기업 계	123,851,954	44,926	65,595,894	15,980

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	119,639	-	1,334,908	213,727
	삼성전기㈜	58,528	-	616,465	-
	삼성SDI㈜	55,502	-	276,577	20,955
	㈜제일기획	35,321	-	609,075	1,163
	기타	398,466	-	687,589	4,383
	관계기업 및 공동기업 계	667,456	-	3,524,614	240,228
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	18,793	70	31,527	3,556,019
	기타	294,039	-	614,475	155,459
	그 밖의 특수관계자 계	312,832	70	646,002	3,711,478
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	917	-	23,761	1,872,404
	㈜에스원	3,576	-	329,834	12,575
	기타	140,115	-	248,556	247,512
	기타 계	144,608	-	602,151	2,132,491

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	173,403	-	664,206	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	28,542,536	632	153,449	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	31	-	23,163	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	5,606,627	-	21,261,392	176
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	151,100	5,135	7,303,357	3,033
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	61,121	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	32,797,055	-	379,902	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1,376,587	-	6,016	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	3,874,486	6	13,052,604	-
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	-	-	-	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	4,746,799	-	4,181,885	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	41	-	2,582,724	1,812
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	1,395,894	-	-	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	13,540,056	-	47	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	950,168	-	1,839	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	472,405	2,775	3,857,287	355
	Samsung International, Inc. (SII)	280,112	216	6,848,352	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	1,332,404	-	2,040,364	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1,175,661	-	76,137	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	3,971,047	-	3,479	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	342,509	142	2,001	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	590,444	-	1,702	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	190,462	-	-	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	3,002,557	-	5,158	-
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1,874,183	-	5,519	-
	기타	43,943,381	3,644	12,956,279	2,214
	종속기업 계	150,329,948	12,550	75,467,983	7,590

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	178,127	-	1,189,797	258,254
	삼성전기㈜	53,949	767	711,850	-
	삼성SDI㈜	48,310	-	313,264	23,135
	㈜제일기획	30,556	-	700,760	361
	기타	378,450	-	587,817	4,592
	관계기업 및 공동기업 계	689,392	767	3,503,488	286,342
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	35,424	-	45,456	4,399,702
	기타	219,514	-	459,773	89,626
	그 밖의 특수관계자 계	254,938	-	505,229	4,489,328
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	1,149	-	24,396	1,731,894
	㈜에스원	3,851	-	315,014	18,544
	기타	102,478	-	222,479	173,163
	기타 계	107,478	-	561,889	1,923,601

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	38,118	103,209
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1,583,309	246,140
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	980	1,430
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	3,794
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	55,867	884,228
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	4,659	415,806
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	908,561	3,432,496
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	4,301,099	196,886
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	253,434	1,941
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	421	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	250,224	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,125,085	489,851
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	392,573	2,360,623
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	234,795	2,520
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	90,360	479,441
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	2,333,746	1,375
	Samsung International, Inc. (SII)	96,305	422,115
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	161,131	171,083
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	81,547	48,015
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	484,441	1,570
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	561,003	1,568
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	12,923	-
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	441,822	69,408
	세메스(주)	40,939	550,611
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	139,536	2,752
	기타	8,115,429	1,439,660
	종속기업 계	21,708,307	11,326,522

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스주	22,929	450,286
	삼성전기주	1,707	90,405
	삼성SDI주	113,775	36,072
	주제일기획	14	319,265
	기타	100,911	175,676
	관계기업 및 공동기업 계	239,336	1,071,704
그 밖의 특수관계자	삼성물산주	190,358	788,083
	기타	14,198	146,274
	그 밖의 특수관계자 계	204,556	934,357
기타(*3)	삼성엔지니어링주	80	298,417
	주에스원	562	39,777
	기타	5,264	342,302
	기타 계	5,906	680,496

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	32,521	108,011
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	868,937	983,709
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,604	1,812
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	6,537
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	57,423	751,693
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	606,030	2,396,411
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	131,285	283,459
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	4,700,427	263,757
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	369,380	1,748,670
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	693	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	21,309	386,640
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	196,643	7
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,219,298	312,243
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	1,623,968	77
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	227,180	3,037
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	234,870	358,082
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	115,103	379,098
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	76,264	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	18,403	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	11,449	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	273,816	506,872
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	20,177	11
	세메스(주)	54,327	561,368
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	10,607	-
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	230,508	1,093
	기타	6,565,258	2,226,116
	계	17,667,480	11,278,703

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	49,439	468,830
	삼성전기(주)	385	101,960
	삼성SDI(주)	114,618	51,199
	(주)제일기획	43	444,017
	기타	203,575	159,668
	관계기업 및 공동기업 계	368,060	1,225,674
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	194,539	2,718,294
	기타	14,679	160,305
	그 밖의 특수관계자 계	209,218	2,878,599
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	286	1,181,947
	(주)에스원	3,085	59,352
	기타	4,113	478,136
	기타 계	7,484	1,719,435

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 대여한 내역은 없으며, 당분기 중 종속기업으로부터 21,990,000백만원을 차입하였습니다(전분기: 차입 내역 없음). 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에게 대여 및 차입한 내역은 없습니다.

마. 회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 26,124백만원 및 105,035백만원을 출자하였으며, 종속기업으로부터 출자원금 124,910백만원 및 164,503백만원을 회수하였습니다. 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 58,982백만원 및 882,125백만원을 출자하였으며, 당분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 518백만원을 회수하였습니다(전분기 회수 내역 없음).

바. 회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,238,585백만원 및 1,249,916백만원입니다. 또한 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 96,174백만원 및 96,174백만원입니다. 당분기말 및 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

사. 회사가 당분기 중 특수관계자와 체결한 신규 리스 이용 계약은 없으며(전분기: 20백만원), 특수관계자에게 지급한 리스료는 13,582백만원 및 35,174백만원입니다.

아. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

자. 회사가 당분기 및 전분기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	7,737	7,236
퇴직급여	418	451
기타 장기급여	5,876	5,434

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021년 1월에 2021~2023년의 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년의 사업연도에도 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하되 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 확대하고 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제55기 3분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		8,449,574	54,730,018	39,243,791
(별도)당기순이익(백만원)		24,159,539	25,418,778	30,970,954
(연결)주당순이익(원)		1,244	8,057	5,777
현금배당금총액(백만원)		7,356,462	9,809,438	9,809,438
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		87.1	17.9	25.0
현금배당수익률(%)	보통주	1.6	2.5	1.8
	우선주	1.9	2.7	2.0
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,083	1,444	1,444
	우선주	1,083	1,445	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은

제 55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
39	42	2.7	2.9

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.0%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.3%입니다.
- ※ 최근 3년간은 2020년(제52기)부터 2022년(제54기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2018년(제50기)부터 2022년(제54기)까지 기간입니다. 2023년(제55기) 3분기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 1.6%, 우선주 1.9%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자(주)	회사채	공모	1997.10.02	134,480	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	537,920	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-
㈜도우인시스	회사채	사모	2022.12.08	42,000	0.5%	-	2027.12.08	미상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.01.30	30,000	4.1%	A1	2023.02.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.01.30	50,000	4.0%	A1	2023.02.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.02.10	70,000	3.9%	A1	2023.03.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.02.28	1,000	4.0%	A1	2023.03.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.02.28	9,000	4.0%	A1	2023.03.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.03.10	70,000	4.1%	A1	2023.04.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.03.28	45,000	4.0%	A1	2023.04.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.04.10	70,000	4.0%	A1	2023.05.10	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.05.10	70,000	4.0%	A1	2023.06.12	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.06.12	50,000	4.1%	A1	2023.07.12	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.07.25	20,000	4.1%	A1	2023.08.28	상환	-
세메스	기업어음증권	사모	2023.07.28	30,000	4.1%	A1	2023.08.28	상환	-
합 계	-	-	-	1,252,400	-	-	-	-	-

※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	544,644	6,724	6,724	6,724	-	-	564,816
	사모	-	23,000	-	-	42,000	-	-	65,000
	합계	-	567,644	6,724	6,724	48,724	-	-	629,816

- 삼성전자주

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	6,724	6,724	6,724	6,724	-	-	26,896
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	6,724	6,724	6,724	6,724	-	-	26,896

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	537,920	-	-	-	-	-	537,920
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	537,920	-	-	-	-	-	537,920

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

- (주)도우인시스

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	23,000	-	-	42,000	-	-	65,000
	합계	-	23,000	-	-	42,000	-	-	65,000

※ (주)도우인시스의 사모 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	134,480	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2023년 3분기 중 처분 자산은 전체의 0.1%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company,

N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(SSL, SSM 법인 매각)

중속기업 삼성디스플레이(주)는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	96,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	777,000	857,000	239,395	27,212	266,607	48.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	25,649	△19,432	6,217	17.0%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.05.31	832,572	801,294	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.01	2024.09.05	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	45,000	20,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.01.18	2023.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	603,960	609,199	513,366	4,453	517,819	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	20,000	20,000	20,000	-	20,000	7.1%
합 계							9,110,532	9,084,493	963,842	△153,199	810,643	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이(주), SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은
 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이(주)의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을
 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.
 한편, 삼성디스플레이(주)는 SDN에게 2022년 중 US\$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결채무제표 주석'을
 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제55기 3분기	해당사항 없음	해당사항 없음
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제55기 3분기말	매출채권	43,800,348	394,393	0.9%
	단기대여금	42,850	204	0.5%
	미수금	6,453,943	84,491	1.3%
	선급금	1,072,502	3,220	0.3%
	장기매출채권	42,346	-	0.0%
	장기미수금	1,429,384	537	0.0%
	장기선급금	4,899,418	9,498	0.2%
	장기대여금	250,999	1,325	0.5%
	합 계	57,991,790	493,668	0.9%
제54기말	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	-	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%
제53기말	매출채권	41,024,295	310,880	0.8%
	단기대여금	17,895	73	0.4%
	미수금	4,569,772	72,515	1.6%
	선급금	1,122,660	3,847	0.3%
	장기매출채권	225,739	-	0.0%
	장기미수금	1,002,404	290	0.0%
	장기선급금	1,770,999	9,003	0.5%
	장기대여금	199,577	917	0.5%
	합 계	49,933,341	397,525	0.8%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기	제54기	제53기
기초 대손충당금(손실충당금)	406,677	397,525	388,943
순대손처리액(① - ② + ③)	△916	16,658	25,926
① 대손처리액(상각채권액) 등	15,541	9,711	22,400
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	△16,457	6,947	3,526
대손상각비 계상(환입)액	86,075	25,810	34,508
기말 대손충당금(손실충당금)	493,668	406,677	397,525

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	43,316,775	399,053	13,655	113,211	43,842,694
구성비율	98.8%	0.9%	0.0%	0.3%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제55기 3분기말	제54기말	제53기말
DX 부문	제품 및 상품	7,269,369	7,712,885	8,894,766
	반제품 및 재공품	657,894	1,013,606	799,218
	원재료 및 저장품	9,353,092	10,520,293	11,384,887
	미착품	1,166,436	943,322	1,299,624
	소 계	18,446,791	20,190,106	22,378,495
DS 부문	제품 및 상품	8,264,325	6,601,087	2,490,097
	반제품 및 재공품	21,766,541	18,756,104	11,809,911
	원재료 및 저장품	3,599,672	3,639,061	2,118,424
	미착품	100,158	61,352	36,685
	소 계	33,730,696	29,057,604	16,455,117
SDC	제품 및 상품	337,298	811,518	294,777
	반제품 및 재공품	642,455	542,473	874,229
	원재료 및 저장품	902,411	788,521	810,325
	미착품	39,372	23,626	48,253
	소 계	1,921,536	2,166,138	2,027,584
Harman	제품 및 상품	916,521	799,919	533,008
	반제품 및 재공품	115,660	119,890	105,271
	원재료 및 저장품	822,964	913,085	736,109
	미착품	452,771	269,715	321,128
	소 계	2,307,916	2,102,609	1,695,516
총 계	제품 및 상품	17,006,514	16,032,226	12,280,579
	반제품 및 재공품	22,886,237	20,077,519	13,473,618
	원재료 및 저장품	13,941,561	14,979,280	14,184,841
	미착품	1,421,645	1,098,841	1,445,366
	소 계	55,255,957	52,187,866	41,384,404
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		12.2%	11.6%	9.7%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]		3.3회	4.1회	4.5회

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
 - 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
 - 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 당사는 2023년 5월 29일부터 6월 5일까지 상반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(5월말)으로 상반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2023년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	19,115,243	19,115,243	△2,108,729	17,006,514
반제품 및 재공품	27,165,172	27,165,172	△4,278,935	22,886,237
원재료 및 저장품	15,044,237	15,044,237	△1,102,676	13,941,561
미착품	1,421,645	1,421,645	-	1,421,645
합 계	62,746,297	62,746,297	△7,490,340	55,255,957

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2023년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제55기 3분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	75,144,284	-	-	-	75,144,284
단기금융상품	17,927,266	-	-	-	17,927,266
단기상각후원가금융자산	-	-	-	-	-
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	31,340	-	31,340
매출채권	43,405,955	-	-	-	43,405,955
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	8,847,905	-	-	8,847,905
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,513,696	-	1,513,696
기타	10,681,724	-	706,440	64,449	11,452,613
계	147,159,229	8,847,905	2,251,476	64,449	158,323,059

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,157,077	-	-	13,157,077
단기차입금	361,873	-	3,980,310	4,342,183
미지급금	12,338,596	-	-	12,338,596
유동성장기부채	281,801	-	993,468	1,275,269
사채	567,683	-	-	567,683
장기차입금	34,396	-	3,830,507	3,864,903
장기미지급금	4,994,752	-	-	4,994,752
기타	11,038,163	273,209	23,454	11,334,826
계	42,774,341	273,209	8,827,739	51,875,289

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2) 제54기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	49,680,710	-	-	-	49,680,710
단기금융상품	65,102,886	-	-	-	65,102,886
단기상각후원가금융자산	414,610	-	-	-	414,610
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,080	-	29,080
매출채권	35,721,563	-	-	-	35,721,563
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	11,397,012	-	-	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,405,468	-	1,405,468
기타	9,945,209	-	334,263	61,404	10,340,876
계	160,864,978	11,397,012	1,768,811	61,404	174,092,205

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	10,644,686	-	-	10,644,686
단기차입금	1,577,958	-	3,569,357	5,147,315
미지급금	16,328,237	-	-	16,328,237
유동성장기부채	215,143	-	874,019	1,089,162
사채	536,093	-	-	536,093
장기차입금	33,846	-	3,526,826	3,560,672
장기미지급금	2,289,236	-	-	2,289,236
기타	12,047,761	334,415	27,353	12,409,529
계	43,672,960	334,415	7,997,555	52,004,930

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기말		제54기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	75,144,284	(*1)	49,680,710	(*1)
단기금융상품	17,927,266	(*1)	65,102,886	(*1)
단기상각후원가금융자산	-	(*1)	414,610	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	31,340	31,340	29,080	29,080
매출채권	43,405,955	(*1)	35,721,563	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,847,905	8,847,905	11,397,012	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	1,513,696	1,513,696	1,405,468	1,405,468
기타(*2)	11,452,613	770,889	10,340,876	395,667
계	158,323,059		174,092,205	
금융부채:				
매입채무	13,157,077	(*1)	10,644,686	(*1)
단기차입금	4,342,183	(*1)	5,147,315	(*1)
미지급금	12,338,596	(*1)	16,328,237	(*1)
유동성장기부채	1,275,269	-	1,089,162	6,580
- 유동성장기차입금	1,275,269	(*1)(*3)	1,082,934	(*1)(*3)
- 유동성사채	-	-	6,228	6,580
사채	567,683	554,372	536,093	521,129
장기차입금	3,864,903	(*1)(*3)	3,560,672	(*1)(*3)
장기미지급금	4,994,752	(*1)	2,289,236	(*1)
기타(*2)	11,334,826	296,663	12,409,529	361,768
계	51,875,289		52,004,930	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,681,724백만원(전기말: 9,945,209백만원)

및 금융부채 11,038,163백만원(전기말: 12,047,761백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제55기 3분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	31,340	-	31,340
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,582,634	-	2,265,271	8,847,905
당기손익-공정가치금융자산	351,910	-	1,161,786	1,513,696
기타	-	372,718	398,171	770,889
금융부채:				
유동성사채	-	-	-	-
사채	-	554,372	-	554,372
기타	-	295,143	1,520	296,663

(단위 : 백만원)

구 분	제54기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	29,080	-	29,080
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,207,295	-	2,189,717	11,397,012
당기손익-공정가치금융자산	314,449	-	1,091,019	1,405,468
기타	-	373,176	22,491	395,667
금융부채:				
유동성사채	-	6,580	-	6,580
사채	-	521,129	-	521,129
기타	-	354,364	7,404	361,768

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2023년 3분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	31,245	현금흐름할인법	영구성장률	1.0%
			가중평균자본비용	18.5%
(주)미코세라믹스	32,191	현금흐름할인법 등	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	15.5%
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,297,590	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.4%
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	215,156	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
			가중평균자본비용	10.4%
기타:				
지분 콜옵션	376,755	이항모형	무위험 이자율	3.9%
			가격 변동성	69.4%
지분 풋옵션	21,416	이항모형	무위험 이자율	4.7%~5.5%, 2.3%
			가격 변동성	22.8%, 27.5%

[△는 부(-)의 값임]

(수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제55기 3분기	제54기 3분기
기초	3,303,227	3,430,214
매입	170,913	155,514
매도	△80,013	△167,601
당기손익으로 인식된 손익	367,233	77,092
기타포괄손익으로 인식된 손익	41,452	89,067
기타	22,416	63,853
분기말	3,825,228	3,648,139

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제55기 3분기	제54기 3분기
기초	7,404	5,438
기타	△5,884	-
분기말	1,520	5,438

[△는 부(-)의 값임]

(‘수준 3’으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2023년 3분기말 현재 ‘수준 3’으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익 효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	132,922	-	△92,531
기타	101,924	-	△93,761	-

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(△1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 3분기 검토를 수행하였으며, 검토 결과 재무제표에 한국채택 국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

안진회계법인은 당사의 제53기, 제54기 감사를 수행하였으며, 감사의견은 모두 적정입니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제55기 3분기 (당분기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제54기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제53기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제55기 3분기 (당분기)	삼정회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사	7,800	85,700	4,914	53,987
제54기 (전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	8,424	78,146
제53기 (전전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	7,900	76,741	7,900	76,999

(제55기 3분기 일정)

구 분		일 정
제55기 1분기	사전검토	2023.03.06 ~ 2023.03.29
	본검토	2023.04.07 ~ 2023.05.12
제55기 2분기	사전검토	2023.06.05 ~ 2023.06.30
	본검토	2023.07.07 ~ 2023.08.11
제55기 3분기	사전검토	2023.09.06 ~ 2023.09.27
	본검토	2023.10.10 ~ 2023.11.14

※ 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제55기 3분기 (당분기)	2017.02	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.09	202	삼정회계법인
	2018.09	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.09	27	
	2019.05	세무자문업무(해외중속기업)	2023.01~2023.09	79	
	2023.05	ESG인증업무(국내중속기업)	2023.05~2023.07	25	
제54기 (전기)	-	-	-	-	-
제53기 (전전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2021.01~2021.12	394	안진회계법인

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2023.01.27	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 4명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
2	2023.04.25	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 분기 검토 경과 보고 연간 회계감사 계획 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
3	2023.07.25	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 선정 계획 내부회계관리제도 감사 진행 상황 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항
4	2023.10.27	<ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 선정 계획 내부회계관리제도 감사 진행 상황 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

[조정협의내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

당사는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정된 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이에 따라 당분기부터 당사 회계감사인은 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경되었습니다.

제55기 3분기말(당분기말) 현재 당사의 종속기업은 233개이며, 당분기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이(주) 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스(주)는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다.

전기 중 설립된 종속기업 (주)희망별숲은 삼정회계법인(KPMG)으로, Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ), DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED가 KPMG를, 당분기 중 설립된 SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 종속기업의 회계감사인 변경 및신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프(주)	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
(주)미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스(주)	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG

Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	PwC	KPMG
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG

Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

제54기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

또한, 제53기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.(SETK-P)가 Deloitte를, 지에프(주)가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, 도우인시스(주)가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험(주)	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험(주)(특별계정)	최대주주 본인	보통주	10,246,942	0.17	8,586,807	0.14	장내매매
삼성생명보험(주)(특별계정)	최대주주 본인	우선주	403,278	0.05	587,198	0.07	장내매매
삼성물산(주)	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험(주)	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	117,302,806	1.96	117,302,806	1.96	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	최대주주의 특수관계인	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이서현	최대주주의 특수관계인	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한중희	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	15,000	0.00	-
경계현	계열회사 임원	보통주	18,050	0.00	21,050	0.00	장내매매
노태문	계열회사 임원	보통주	13,000	0.00	13,000	0.00	-
박학규	계열회사 임원	보통주	22,500	0.00	22,500	0.00	-
이정배	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	15,000	0.00	-
김한조	계열회사 임원	보통주	3,655	0.00	3,655	0.00	-
계		보통주	1,237,981,437	20.74	1,236,324,302	20.71	-
		우선주	1,067,128	0.13	1,251,048	0.15	-

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 2023년 9월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

※ 최대주주의 특수관계인(홍라희, 이부진, 이서현) 소유주식 중 일부에 대해 2023년 10월 31일자로 유가증권처분신탁 계약을 체결하였습니다.

자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 2023년 11월 3일자 '주식등의 대량보유상황보고서(일반)'를 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험주	90,299	전영목	0.00	-	-	삼성물산주	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 2023년 9월 30일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.16	전영목	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이건희	-
2021.04.29	-	-	-	-	삼성물산주	19.34

※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산주로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험주
자산총계	297,084,670
부채총계	252,422,191
자본총계	44,662,479
매출액	23,332,112
영업이익	1,796,470
당기순이익	1,449,726

※ 재무현황은 2023년 09월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험주(주)은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 주요 종속기업인 삼성카드(주)는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험주(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산주	166,651	고정석	0.00	-	-	이재용	18.26
		오세철	0.00	-	-	-	-
		정해린	0.00	-	-	-	-

※ 2023년 09월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.19	고정석	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	오세철	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이재용	18.13
2023.03.17	한승환	-	-	-	-	-
2023.03.17	정해린	0.00	-	-	-	-
2023.04.21	-	-	-	-	이재용	18.26

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며,

고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.13%)되었습니다.

※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산주
자산총계	62,484,018
부채총계	25,539,836
자본총계	36,944,182
매출액	31,795,935
영업이익	2,243,207
당기순이익	2,147,792

※ 재무현황은 2023년 09월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기 임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주 와의 관계	재직기 간	임기 만료일
								의결권 있는 주 식	의결권 없는 주 식			
한중희	남	1962.03	부회장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	15,000	-	계열회사 임원	43개월	2026.03.17
경계현	남	1963.03	사장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄)	· 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부문장	21,050	-	계열회사 임원	19개월	2025.03.15
노태문	남	1968.09	사장	사내 이사	상근	· MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	13,000	-	계열회사 임원	19개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내 이사	상근	· CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	22,500	-	계열회사 임원	19개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내 이사	상근	· 메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	15,000	-	계열회사 임원	19개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외 이사	비상근	· 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융나눔재단 이사장	3,655	-	계열회사 임원	55개월	2025.03.19
김선옥	여	1952.12	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	계열회사 임원	67개월	2024.03.22
김중훈	남	1960.08	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Maryland대 신외성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	계열회사 임원	67개월	2024.03.22
김준성	남	1967.10	이사	사외 이사	비상근	· 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토털리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	19개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	-	계열회사 임원	11개월	2025.11.02
유명희	여	1967.06	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 서울대 국제대학원 객원교수	-	-	계열회사 임원	11개월	2025.11.02

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은영, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 주주총회를 통해 한종희 사내이사가 재선임되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기 업 명	직 위	재 임 기 간
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년~현재
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
김기남	남	1958.04	회장	상근	SAIT 회장	DS부문장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주 의 특수관 계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
강인엽	남	1963.07	사장	상근	미주담당 사장	System LSI사업부장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	37
김우준	남	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	제조담당	글로벌인프라총괄	연세대(박사)	계열회사 임원	
박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산 건설부문 커뮤니케이션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	10
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	

백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
승현준	남	1966.06	사장	상근	Samsung Research 글로벌 R&D협력담당	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	글로벌마케팅실장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이원진	남	1967.08	사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
진교영	남	1962.08	사장	상근	SAIT 원장	메모리사업부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	10
강문수	남	1969.08	부사장	상근	AVP사업팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	51
강봉구	남	1962.02	부사장	상근	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	Samsung Research Robot센 터장	무선 개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	9
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발 실장	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	Stanford Univ., Research Fellow	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	43
고승환	남	1962.09	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
고재운	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	메모리 인사팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형중	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실 장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽성웅	남	1965.05	부사장	상근	System LSI Design Platform개 발팀장	System LSI Security&Power제 품개발팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	58
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	

구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흥	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실장	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
권오상	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권환준	남	1971.09	부사장	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	Qualcomm, Sr. Director	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	19
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략 팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경진	남	1963.11	부사장	상근	DX부문 CSO, Global EHS센터 장	영상디스플레이 Global제조팀 장	숭실대(학사)	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 법무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	47
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담 당임원	Moda Operandi, CMO	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀 담 당임원	서남아총괄 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research SoC Architecture팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김도현	남	1975.03	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	22
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI CP개발실장	System LSI SOC개발실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담 당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	남	1973.02	부사장	상근	메모리 People팀장	Samsung Research 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김사필	남	1965.04	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	경찰대(학사)	계열회사 임원	
김선식	남	1964.06	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	

김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	감사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	생활가전 지원팀장	한국총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략지원담당	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	27
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용주	남	1970.08	부사장	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 중대형사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-AVP 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	15
김원경	남	1967.08	부사장	상근	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 GPO팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
김이태	남	1966.02	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(박사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재묵	남	1965.05	부사장	상근	생활가전 구매팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀장	국민대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재윤	남	1963.03	부사장	상근	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

김재훈	남	1967.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SELA법인장	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김정현	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
김종현	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 People팀장	Foundry 인사팀장	육사(학사)	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	계열회사 임원	
김찬우	남	1976.04	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
김창업	남	1969.08	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1969.04	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1966.01	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀 담당임원	Morrow Sodali, Managing Director	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	20
더못라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE총괄	DS부문 구조총괄 담당임원	Limerick Regional Technical Coll.(학사)	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	SEIB법인장	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	32

도현호	남	1967.10	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	19
디페이	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
류경동	남	1970.01	부사장	상근	SAIT 담당임원	Google, Director	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	1
린준청	남	1970.07	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	Skytech, CEO	NTUST(박사)	계열회사 임원	9
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	19
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	58
문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생산기술연구소장	SEDA-P(M) 공장장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건대	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박길재	남	1966.04	부사장	상근	Global CS센터장	Mobile eXperience 품질혁신센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박성선	남	1965.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대(학사)	계열회사 임원	
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
박성준	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	경북대(석사)	계열회사 임원	

박수남	남	1970.10	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	57
박순철	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Virginia Tech, 교수	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	33
박정호	남	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	반도체연구소 DRAM TD실장	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	58
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	SRA 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	58
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀장	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	생활가전 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬익	남	1972.04	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 기획팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	50
박현정	남	1969.12	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박형원	남	1966.09	부사장	상근	System LSI Global Operation실장	System LSI 품질팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박훈중	남	1967.08	부사장	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
서병훈	남	1963.07	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	58
서한석	남	1968.02	부사장	상근	SEA 담당임원	SEDA-S판매부문장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서행룡	남	1967.09	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	

성일경	남	1964.01	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	북미총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌환경안전/인프라센터장	아주대(박사수료)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
송병무	남	1973.08	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터장	TSP총괄 TP센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	54
송원득	남	1964.01	부사장	상근	DS부문 IP팀장	법무실 IP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승원	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	KAIST, 교수	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	33
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유균	남	1965.02	부사장	상근	반도체연구소 차세대연구실장	반도체연구소 공정개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	Veolia, Tech leader	Technical Univ. of Munich(박사)	계열회사 임원	1
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	영상디스플레이 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심은수	남	1966.10	부사장	상근	SAIT System Research Center장	DIT센터장	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	

안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당 임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안용일	남	1971.02	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	디자인경영센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
안장혁	남	1967.12	부사장	상근	네트워크 지원팀장	SEVT 담당임원	육사(학사)	계열회사 임원	
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	반도체연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양세영	남	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당 임원	세종대(학사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
염대현	남	1966.03	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	58
염재훈	남	1966.06	부사장	상근	DS부문 DS대외협력팀장	DS부문 상생협력센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	58
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	TSP총괄 지원팀장	System LSI 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 미주총괄 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 담당임 원	서강대(석사)	계열회사 임원	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀장	Polytechnic Univ. of NY(석 사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	

원성근	남	1968.05	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기 전략마케팅팀장	삼성메디슨 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	10
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 S/W개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Mobile eXperience 전략기획팀 장	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유승호	남	1968.06	부사장	상근	지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	35
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	LAM Research, Sr.Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	18
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Qualcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	17
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤종식	남	1961.09	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry CTO	Univ. of California, LA(박 사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	기획팀 담당임원	네트워크 기획팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤철운	남	1962.11	부사장	상근	SEHC법인장	영상디스플레이 Global운영팀 장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	DS부문 CSO, 글로벌 제조&인 프라총괄	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
이경우	남	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
이광현	남	1971.06	부사장	상근	Mobile eXperience People팀 장	인사팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	계열회사 임원	
이규필	남	1961.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	반도체연구소 메모리TD실장	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	

이규호	남	1969.06	부사장	상근	People팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이금주	여	1971.09	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	
이동근	남	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	58
이동기	남	1969.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	
이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	Mobile eXperience Global제조 센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	
이상도	남	1969.03	부사장	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
이상원	남	1971.07	부사장	상근	서남아총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담 당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상재	남	1965.12	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	TSP총괄 TP센터 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상현	남	1966.05	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry Design Platform개발 실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상훈	남	1973.04	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Intel, Sr. Principal Engineer	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	14
이석원	남	1970.07	부사장	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI AP개발실장	System LSI SOC개발실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이성수	남	1964.11	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이성현	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SGE법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이승욱	남	1967.02	부사장	상근	전장사업팀장	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Akron(박사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	31
이영수	남	1972.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	Shell, General Manager	MIT(박사)	계열회사 임원	6
이영호	남	1967.07	부사장	상근	중국사업혁신팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mercedez-Benz, CDO of China	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	10
이재범	남	1970.10	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI개발실장	System LSI LSI개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI CP개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	33
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	9
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담 당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	무선 기획팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종철	남	1968.01	부사장	상근	법무실 담당임원	Compliance팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 담당임원	메모리 DRAM개발실장	Univ. of California, LA(박 사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대가 전연구팀장	생활가전 선행개발팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	
이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원	Meta, Creative Director	Parsons School of Design(학사)	계열회사 임원	14
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이청용	남	1968.12	부사장	상근	SAVINA-S법인장	Mobile eXperience 전략마케 팅실 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	영상디스플레이 영상전략마케 팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	

이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	36
이현	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	TSE-S법인장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
이현	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEF 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	Qualcomm, Sr. Director Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	43
임근휘	남	1973.05	부사장	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	22
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	57
임성택	남	1966.06	부사장	상근	중동총괄	SEI법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
임준서	남	1968.08	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀장	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장성대	남	1964.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터장	동국대(학사)	계열회사 임원	
장성진	남	1965.07	부사장	상근	TSP총괄 담당임원	TSP총괄	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치 Tech&Future본부장	Case Western Reserve Univ.(박사)	계열회사 임원	10
장세연	남	1967.01	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	54
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	반도체연구소 Flash TD실장	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장종산	남	1964.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소장	글로벌인프라총괄 환경안전연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	42
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	로봇사업팀장	로봇사업화T/F장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀장	삼성글로벌리서치 글로벌전략실 담당임원	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	10

정기봉	남	1970.01	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 IP팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry CTO	Foundry 기술개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정상섭	남	1966.11	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 장	SAS법인장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정상태	남	1972.01	부사장	상근	생활가전 전략마케팅 담당임 원	SEA 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정서형	남	1967.05	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	신사업T/F장	Goldman Sachs, SVP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	14
정완영	남	1965.05	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
정용준	남	1969.10	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실장	SEA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research Global 시센터 담당임원	Apple, Sr. Engineering Mgr	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	11
정재현	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신 센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	34
정현준	남	1964.06	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	영상디스플레이 Micro LED팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	남	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기재	남	1967.01	부사장	상근	DS부문 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	감사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	System LSI A-Project팀장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대(학사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	

조영준	남	1971.05	부사장	상근	북미총괄 People팀장	네트워크 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	SDI 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	18
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SEUK법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원 팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주드버클 리	남	1970.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEA EVP	Queensland Univ.(학사)	계열회사 임원	22
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스 고객지원실 담 당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	45
주은기	남	1962.01	부사장	상근	상생협력센터장	상생협력센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
주혁	남	1971.10	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실 담 당임원	종합기술원 Device연구센터 담 당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	메모리 기획팀장	SCS 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리트	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소 연구조정실 담 당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	25
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담 당임원	무선 상품전략팀장	광운대(학사)	계열회사 임원	
최강석	남	1965.12	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원	Univ of California, Irvine(학 사)	계열회사 임원	47
최경세	남	1969.04	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실장	TSP총괄 Package개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터장	서울대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	49
최승걸	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로 벌EHS/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터장	서울시립대(학사)	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략 팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	생명 기획팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	10

최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실장	생산기술연구소 설비개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	LED사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	SESA법인장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
최정준	남	1965.08	부사장	상근	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	AMAT, Managing Director	Univ. Of Arizona(박사수료)	계열회사 임원	11
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 Solution개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	SAIT AI Research Center장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
추종석	남	1962.09	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	구주총괄	Univ. of Missouri, Columbia(석사)	계열회사 임원	
패트릭쇼메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한인택	남	1966.10	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
한지니	여	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience Digital Life팀장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	37
한진만	남	1966.10	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	메모리 전략마케팅실장	서울대(학사)	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성희	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
홍기채	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	계열회사 임원	27
홍두희	남	1964.02	부사장	상근	감사팀장	무선 지원팀장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	

홍범석	남	1968.06	부사장	상근	아프리카총괄	Iran지점장	중앙대(학사)	계열회사 임원	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	DS부문 담당임원	Fairchild, Principal Engineer	서울대(석사)	계열회사 임원	4
홍성민	남	1969.06	부사장	상근	Foundry People팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Univ. of California, LA(석사)	계열회사 임원	
홍형선	남	1963.08	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실장	인하대(석사)	계열회사 임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research Center장	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사 임원	4
황기현	남	1967.06	부사장	상근	제조담당 제조시너지팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE영업팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	제조담당 메모리제조기술센터 장	SCS법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI Design Platform개발팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	25
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	58
강동구	남	1976.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	58
강동우	남	1971.04	상무	상근	제조담당 AVP제조기술센터장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	45
강동훈	남	1970.12	상무	상근	범무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	10
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	22
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	45
강보경	여	1976.12	상무	상근	System LSI Design Platform개발팀 담당임원	System LSI Design Platform개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
강상용	남	1972.09	상무	상근	전자사업팀 담당임원	SEG 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	58
강석채	남	1971.06	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	

강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	45
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	30
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	3
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발 센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
강정대	남	1970.09	상무	상근	재경팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	22
강태규	남	1972.01	상무	상근	IR팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
강태우	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	58
강태형	남	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	2
강혁	남	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	10
강희성	남	1970.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임 원	Flex, Sr. Director	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	10
고승범	남	1971.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	58
고알시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	38
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	52
고의종	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	22
고정욱	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	45
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
고택균	남	1971.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	34
고형석	남	1972.09	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	58
공병진	남	1971.09	상무	상근	SIEL-P(C)공장장	생활가전 Global운영팀 담당부 장	항공대(학사)	계열회사 임원	34

곽진환	남	1968.01	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SRIL연구소장	Santa Clara Univ.(석사)	계열회사 임원	
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	On Semiconductor, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
구봉진	여	1971.05	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	58
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	48
권기덕	남	1972.07	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	58
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	34
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	SRUK연구소장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	45
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	34
권영훈	남	1972.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	NXP, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
권오경	남	1977.08	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	16
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	8
권진현	남	1968.07	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	58
권춘기	남	1969.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	SEEG-P법인장	포항공대(학사)	계열회사 임원	34
권태훈	남	1971.02	상무	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 상품기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	45
권혁우	남	1973.07	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	15
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 동남아총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석사)	계열회사 임원	34
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	

김건우	남	1976.01	상무	상근	SEH-P 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부 장	MIT(석사)	계열회사 임원	22
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	22
김경준	남	1969.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	58
김경태	남	1973.12	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	34
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	10
김광연	남	1965.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	22
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	10
김구영	남	1975.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	TSP총괄 Package개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	22
김기남	남	1964.08	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
김기수	남	1970.02	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김기수	남	1976.05	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
김기연	남	1972.06	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 DSC 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	10
김기호	남	1966.03	상무	상근	SRA 담당임원	SRI-Delhi연구소장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	42
김대신	남	1970.03	상무	상근	핵심센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	58
김대우	남	1970.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	SME법인장	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	10
김덕현	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	44
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45
김도기	남	1975.05	상무	상근	반도체연구소 People팀장	인사팀 담당부장	숭실대(학사)	계열회사 임원	10
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	22
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	22
김동욱	남	1969.06	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	

김동준	남	1973.05	상무	상근	TSLED법인장	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	30
김릉	남	1971.12	상무	상근	People팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	34
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	34
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	22
김문수	남	1977.12	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
김민우	남	1978.06	상무	상근	TSE-S 담당임원	SESP법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	34
김병진	남	1975.02	상무	상근	SEAU 담당임원	SERC 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사)	계열회사 임원	58
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	19
김보창	남	1977.09	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	10
김봉수	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	34
김상윤	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECE법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	34
김상윤	남	1969.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Synopsys, Technical Member	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	44
김상호	남	1967.10	상무	상근	SRA 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
김상훈	남	1968.02	상무	상근	SEI 담당임원	SENA 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
김석희	남	1971.11	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	34
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	10
김선정	남	1973.02	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	22
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	58
김성기	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	북미총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	22
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김성은	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	45
김성한	남	1970.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	10
김세훈	남	1975.01	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	10
김수련	여	1967.04	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	MIT(박사)	계열회사 임원	58
김수홍	남	1972.11	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	45
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	단국대(학사)	계열회사 임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	34
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
김연정	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	무선 상품전략팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	22
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	4
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	10
김영정	남	1972.03	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
김영주	남	1973.07	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	22
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	44
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	34
김용성	남	1973.09	상무	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
김용완	남	1970.04	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	45
김용찬	남	1969.03	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	58
김용환	남	1976.02	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	22
김용훈	남	1972.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	한양대(학사)	계열회사 임원	34

김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	57
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	22
김원우	남	1970.03	상무	상근	SEDA-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	45
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	58
김유나	여	1979.01	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Platform팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	22
김윤재	남	1973.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	58
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	34
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	58
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
김일홍	남	1974.02	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
김장환	남	1975.08	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	45
김재영	남	1971.11	상무	상근	SECA 담당임원	SIEL-S 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
김재윤	남	1970.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	전자사업팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	58
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	34
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석변호사	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	10
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	24
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정현	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	11
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	58

김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종근	남	1967.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전자사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김중훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	10
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Project Management팀장	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준성	남	1975.08	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	10
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SEHC 담당임원	SESK 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
김중정	남	1973.11	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	
김지영	남	1970.04	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	10
김지윤	여	1975.02	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	58
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	22
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대(학사)	계열회사 임원	22
김진기	남	1972.01	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	22
김진성	남	1971.02	상무	상근	SEVT 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	45
김진주	남	1969.05	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEIB 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	34
김창용	남	1973.04	상무	상근	SAIT People팀장	종합기술원 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	22
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대(학사)	계열회사 임원	
김철주	남	1976.07	상무	상근	SRR연구소장	SRR 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
김태경	남	1971.03	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	Intel, Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	5
김태균	남	1976.02	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	22

김태균	남	1969.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김태수	남	1971.11	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	45
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	29
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	58
김태정	남	1972.12	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	34
김태종	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태진	남	1969.01	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개발실 담당부장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	58
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	34
김평진	남	1973.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(학사)	계열회사 임원	
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
김현	남	1968.07	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	SEVT 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	22
김현기	남	1973.01	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	10
김현덕	남	1981.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	Meta, Software Engineer	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	9
김현석	남	1976.10	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당 임원	고려대(박사)	계열회사 임원	22
김현수	남	1970.09	상무	상근	Samsung Research 기술전략 팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당 임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현조	남	1970.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
김현종	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	34
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀장	한국총괄 CE영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	58
김현철	남	1969.05	상무	상근	반도체연구소 CIS TD팀 담당 임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	45
김형로	남	1973.01	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	22
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	45
김형재	남	1970.12	상무	상근	SEM-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	

김형준	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	송실대(석사)	계열회사 임원	22
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	49
김후성	남	1972.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희승	남	1970.09	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	45
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	45
남경인	남	1973.03	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	58
남기돈	남	1972.09	상무	상근	재경팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	중앙대(학사)	계열회사 임원	45
남정만	남	1967.06	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	남	1969.03	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	한국토지주택공사, 부장	경북대(박사수료)	계열회사 임원	3
노강호	남	1978.05	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
노경래	남	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	58
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	25
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	45
노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	34
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	34
노태현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
다니엘아 라우조	남	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	10
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	34
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	34
류일곤	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
류효경	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	35
마피유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	45

명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	45
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	45
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문국철	남	1969.01	상무	상근	SEVT 담당임원	SVCC 담당임원	구미1대(전문대)	계열회사 임원	
문진욱	남	1971.12	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	45
문형준	남	1968.07	상무	상근	반도체연구소 기술기획팀 담당임원	System LSI 기획팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	22
민재호	남	1976.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
민현진	남	1974.06	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	34
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원	Amazon, Applied Science Mgr	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	11
박래순	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	삼성전기 인사지원그룹장	Peking Univ.(석사)	계열회사 임원	14
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	34
박민철	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
박병주	남	1966.04	상무	상근	인재개발원 담당임원	Samsung Research S/W혁신센터 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박병률	남	1968.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	52
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	10
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
박봉대	남	1974.10	상무	상근	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	45
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	31
박상도	남	1973.12	상무	상근	북미총괄 담당임원	북미총괄 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	45
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	22
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	

박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	22
박성제	남	1971.05	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	34
박성철	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	10
박세근	남	1974.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	45
박장목	남	1967.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대(학사)	계열회사 임원	
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	34
박재범	남	1977.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	22
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	58
박재식	남	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	10
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	34
박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	45
박정호	남	1974.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	45
박제영	남	1969.09	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당부장	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종규	남	1969.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	
박종만	남	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	22
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	22
박종욱	남	1968.11	상무	상근	Global CS센터 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박준수	남	1967.08	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	13
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEBN법인장	SEA 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	34
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	

박진수	남	1969.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	58
박진표	남	1972.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
박찬형	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	10
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	31
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철민	남	1971.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	44
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	22
박충신	남	1973.09	상무	상근	의료기기 People팀장	의료기기 인사팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	34
박대상	남	1975.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	22
박행철	남	1970.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	34
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	45
박현준	남	1978.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	사업지원T/F 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	10
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	SEAD법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	34
박호우	남	1971.03	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
박훈철	남	1974.05	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	22
박희결	남	1972.08	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	32
반수형	남	1972.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	아주대(학사)	계열회사 임원	10
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	45
발라지	남	1969.09	상무	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	58
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	

배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
배상기	남	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	45
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
배일환	남	1970.07	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
배학범	남	1963.08	상무	상근	SESK법인장	SEHC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	34
백기열	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	10
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research 차세대가전연구팀 담당임원	Samsung Research Robot센터 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	22
백일섭	남	1968.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	상무	상근	지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	45
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	생활가전 디자인팀장	제주대(학사)	계열회사 임원	
서경현	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	22
서보철	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	11
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	45
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	CS환경센터 담당부장	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서원주	남	1976.07	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	22
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	45
서창우	남	1974.06	상무	상근	SEF 담당임원	SEBN 담당부장	Manchester(석사)	계열회사 임원	10
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Airbnb, Director	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	19

서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	23
석종욱	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 LED제조기술팀장	글로벌인프라총괄 LED제조기 솔팀장	광운대(학사)	계열회사 임원	
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
성덕용	남	1973.09	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 수석	한양공고(고교)	계열회사 임원	22
성한준	남	1971.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	45
소재민	남	1983.04	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	전남대(석사)	계열회사 임원	34
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
손영아	여	1973.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	SELA 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	10
손영용	남	1970.10	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담 당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	45
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담 당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
손준호	남	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	Mobile eXperience 지원팀 담 당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	10
손중근	남	1970.09	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(박사)	계열회사 임원	
손태용	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀장	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	58
손현석	남	1976.03	상무	상근	SEH-P법인장	SEH-P 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
손호민	남	1969.02	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	45
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	무선 구매팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	34

송명숙	여	1972.11	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	58
송방영	남	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	58
송보영	여	1976.10	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	10
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	31
송영근	남	1970.01	상무	상근	제조담당 AVP제조기술센터 담당임원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	계열회사 임원	9
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
송원준	남	1969.04	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	10
송윤중	남	1971.10	상무	상근	반도체연구소 차세대연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	58
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	58
송정우	남	1977.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	State Univ. Of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	10
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	45
셰인희비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	34
신대중	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SEDA-P(C)공장장	경북대(학사)	계열회사 임원	45
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국해양대(학사)	계열회사 임원	10
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	34
신상용	남	1973.05	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
신승주	남	1972.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SESA 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	45
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	22
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	10
신의창	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	7
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	34

신현석	남	1969.05	상무	상근	신사업T/F 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	4
심우철	남	1982.06	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
심재혁	남	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	Dupont Korea, 상무	서강대(학사)	계열회사 임원	12
심재현	남	1972.01	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	22
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	34
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	34
안성준	남	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Engineering팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
안승환	남	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	58
안신현	남	1972.09	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	22
안용석	남	1974.11	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담 당임원	반도체연구소 DRAM TD실 수 석	서울대(석사)	계열회사 임원	10
안재용	남	1977.02	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
안정희	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEMAG법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	
안주원	여	1977.03	상무	상근	생활가전 기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	10
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	24
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	10
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	10
양병덕	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	34
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	10

양준철	남	1972.06	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	45
양진기	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	58
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	58
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	45
여태정	남	1970.06	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	22
영강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	34
영부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
영종범	남	1977.06	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	10
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	22
오상진	남	1977.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	22
오석민	여	1974.07	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	45
오승훈	남	1968.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	충남대(학사)	계열회사 임원	10
오용찬	남	1972.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
오재균	남	1972.02	상무	상근	System LSI 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정환	남	1973.12	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	58
오창민	남	1965.02	상무	상근	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	SEV 담당임원	무선 구매팀 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	34
오창환	남	1969.01	상무	상근	DS부문 창의혁신센터장	DS부문 경영지원실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	45
오형석	남	1970.09	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	22

왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mobile eXperience CX실 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
우형동	남	1970.09	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	58
원석준	남	1970.02	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	22
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	34
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
유성호	남	1973.02	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	System LSI 지원팀 담당부장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	22
유승	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	22
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	45
유한중	남	1973.10	상무	상근	SEF 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	34
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	45
육근성	남	1968.08	상무	상근	한국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	58
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual Technology팀 담당임원	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	16
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	58
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	22
윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	32
윤석호	남	1972.07	상무	상근	LED사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센 터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤석호	남	1973.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	한국기계연구원, 열에너지솔루 션실장	서울대(박사)	계열회사 임원	9
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	22
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사 임원	9
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	State Univ. of New York, Buffalo(석사)	계열회사 임원	10
윤승호	남	1974.10	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	22
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	48

윤여완	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	34
윤영조	남	1975.02	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	42
윤우근	남	1972.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	32
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	58
윤주환	남	1970.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	58
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SERC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	58
윤하룡	남	1971.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	45
은성민	남	1977.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	10
이강규	남	1972.09	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	34
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global운영팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	45
이경준	남	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	22
이계복	남	1969.06	상무	상근	SEM-P법인장	SEHA법인장	홍익대(학사)	계열회사 임원	45
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	22
이관수	남	1969.11	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	22
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대(학사)	계열회사 임원	45
이규영	남	1968.10	상무	상근	LED사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	45
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	58
이기록	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	

이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	45
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	33
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	34
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	34
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	46
이동현	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	고려대(학사)	계열회사 임원	
이두희	남	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	10
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이범섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	22
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	10
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	34
이병철	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	22
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	10
이병현	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	22
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	22
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	34
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	10
이상훈	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	51
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SAMCOL법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	10
이상희	남	1974.09	상무	상근	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22

이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	22
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
이성원	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
이성원	남	1978.10	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	13
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	24
이성훈	남	1975.11	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 Flash TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	10
이수용	남	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 Master	한양대(석사)	계열회사 임원	14
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대(학사)	계열회사 임원	44
이승목	남	1973.09	상무	상근	System LSI People팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	58
이승엽	남	1968.08	상무	상근	SEIN-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
이승재	남	1974.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이승준	남	1974.04	상무	상근	반도체연구소 Flash TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	10
이승철	남	1975.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
이승철	남	1977.11	상무	상근	DS부문 담당임원	Panjit, Director	서울대(박사)	계열회사 임원	3
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	34
이승환	남	1971.05	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	22
이승훈	남	1976.03	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	58
이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	남	1974.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	혁신센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	10
이우용	남	1975.10	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	10
이원용	남	1978.11	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	SAIT 기획지원팀 수석	MIT(박사)	계열회사 임원	10
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수석	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	34

이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	34
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	34
이의형	남	1975.09	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	10
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	45
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	22
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	58
이정삼	남	1967.06	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	TSP총괄 기획팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	49
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global운영팀 담당임 원	경북대(학사)	계열회사 임원	34
이정자	여	1969.04	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	3
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 People팀장	한국총괄 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	22
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	45
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	11
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI Design Platform개 발팀 담당임원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	58
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	45
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	45
이종필	남	1973.11	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	충남대(석사)	계열회사 임원	45
이종호	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
이주형	남	1972.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담 당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	49
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	23

이종원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
이지석	남	1978.04	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	LAM Research, Director	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	2
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	22
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	45
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	34
이진구	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당 임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 DS대외협력팀 담당임 원	DS부문 상생협력센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	22
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	생활가전 Global CS팀 담당부 장	서울대(박사)	계열회사 임원	45
이창엽	남	1970.04	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	58
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	22
이치훈	남	1969.08	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이한관	남	1971.09	상무	상근	SRA 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	19
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이혁	남	1973.02	상무	상근	Bloom T/F 담당임원	삼성카드, 상무	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	4
이현동	남	1972.02	상무	상근	SELV법인장	Lebanon지점장	영남대(학사)	계열회사 임원	22
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	34
이현정	여	1977.12	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
이현정	여	1971.11	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 Retail마케팅팀장	고려대(박사)	계열회사 임원	22
이형우	남	1970.03	상무	상근	북미총괄 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임 원	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	58

이흥빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	명지대(학사)	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Dupont, APAC EHS Head	성균관대(석사)	계열회사 임원	21
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라 기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
임백준	남	1968.07	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
임산	남	1973.03	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
임성수	남	1978.11	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담 당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
임성택	남	1970.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	58
임순규	남	1979.07	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 대형 지원팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	10
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅 담당부 장	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	34
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	34
임전식	남	1969.08	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	58
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	39
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경훈	남	1970.02	상무	상근	Samsung Research Robot센 터 담당임원	Samsung Research Robot센 터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	45
장소연	여	1971.06	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	58
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	34
장실원	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	58
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	34
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	10
장윤희	남	1974.09	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	10

장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
장정렬	남	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(석사)	계열회사 임원	10
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEASA법인장	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	34
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	38
장흥민	남	1972.06	상무	상근	동남아총괄 CS팀장	Global CS센터 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
저메인클 라우제	남	1982.08	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	10
전대호	남	1971.01	상무	상근	제조담당 People팀장	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	34
전병준	남	1976.07	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	Foundry 지원팀 담당부장	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	10
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	58
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	10
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	22
전소영	여	1974.05	상무	상근	SEA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	34
전승수	남	1976.07	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	34
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 수석	Univ. Of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	10
전진규	남	1974.05	상무	상근	SENA 담당임원	SEAG 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	34
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	13
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	22
정광민	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEPR법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	22
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	22
정광희	남	1971.08	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	58
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	22
정다운	남	1980.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45

정우경	남	1971.05	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	45
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	송실대(학사)	계열회사 임원	24
정상일	남	1967.09	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀 담당임원	메모리 Global운영팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	22
정성원	남	1971.12	상무	상근	SCA법인장	Senegal지점장	고려대(학사)	계열회사 임원	22
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	58
정승일	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	10
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	34
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	22
정연일	남	1975.06	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	10
정영환	남	1971.08	상무	상근	SCIC 담당임원	SET법인장	복단대(석사)	계열회사 임원	10
정용덕	남	1976.09	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
정원석	남	1971.07	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	45
정원철	남	1973.12	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
정유진	여	1970.06	상무	상근	SENA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	58
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	베트남복합단지 담당임원	감사팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의욱	남	1968.07	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	45
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	45
정인호	남	1975.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	45
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	22
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	58
정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	22
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34

정준수	남	1970.09	상무	상근	SEEG-P법인장	SERK법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	22
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅 담당임원	생활가전 전략마케팅 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
정진국	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	58
정한기	남	1976.05	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	10
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	22
정혜순	여	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	
정희재	남	1971.04	상무	상근	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인팀 수석	서울시립대(학사)	계열회사 임원	34
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	45
제임스휘슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High School(고교)	계열회사 임원	22
제희원	남	1978.09	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI CP개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
조강욱	남	1977.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	10
조나단림	남	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	1
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅 담당임원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	9
조민정	여	1974.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	58
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
조성제	남	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 담당부장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	10
조성훈	남	1970.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	건국대(박사)	계열회사 임원	
조성훈	남	1976.01	상무	상근	생활가전 People팀장	생활가전 인사팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	45
조성희	남	1974.08	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	10
조신형	남	1972.10	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 커뮤니케이션팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	45
조영석	남	1976.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	10
조영진	남	1979.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	10
조용호	남	1970.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조육래	남	1972.03	상무	상근	제조담당 지원팀장	DS부문 재경팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	34

조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마케팅팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Global EHS센터 담당부장	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	34
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	22
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	22
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	45
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	34
조철호	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
조학주	남	1969.03	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	10
조호근	남	1977.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of California, LA(석사)	계열회사 임원	10
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	20
조희권	남	1976.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire(학사)	계열회사 임원	58
주명휘	남	1963.08	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(석사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	울산대(학사)	계열회사 임원	22
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SESAR법인장	SEIL법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	34
지송하	여	1973.01	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅실 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
지우정	남	1967.11	상무	상근	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	Mobile eXperience사업부 개발실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	10
진인식	남	1971.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	34

차경환	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	45
차이위엔천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager	NTUST(석사)	계열회사 임원	12
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	5
천기철	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	34
천상필	남	1969.05	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	구주총괄 대외협력팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	45
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	34
최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
최동준	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	34
최병희	남	1970.05	상무	상근	SETK법인장	SEB법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	34
최상중	남	1973.03	상무	상근	제조담당 담당임원	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	34
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	22
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI AP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 Master	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	22
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최순	남	1970.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	22
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	58
최영돈	남	1972.12	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	34
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	38
최원경	여	1973.08	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	45
최유중	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	인사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	22

최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	10
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	충남대(학사)	계열회사 임원	10
최재혁	남	1974.06	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	생활가전 지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	34
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	58
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	10
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	34
최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	45
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	22
최창훈	남	1972.02	상무	상근	제조담당 제조시너지팀 담당임 원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	58
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	남	1974.04	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	10
최청호	남	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	9
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	10
최현호	남	1979.06	상무	상근	SAIT Material Research Center 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	34
최호규	남	1968.12	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	34
추민기	남	1975.10	상무	상근	SECE법인장	SEUZ법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	10
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석 사)	계열회사 임원	22
카리아타 카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	東北大(박사)	계열회사 임원	11
코너피어 스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	58
편정우	남	1970.10	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	22
하헌재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 담당부장	광운대(학사)	계열회사 임원	10

한규희	남	1974.01	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	22
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	10
한상섭	남	1972.04	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	광운대(석사)	계열회사 임원	22
한상연	남	1969.01	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한상욱	남	1974.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Mobile eXperience 개발실 수석	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	10
한우섭	남	1967.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한의택	남	1974.02	상무	상근	SIEL-S 담당임원	SME법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	45
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
한중호	남	1976.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEI 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	34
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	45
한진우	남	1980.07	상무	상근	반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	17
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	58
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	10
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원	한국화학연구원 환경자연연구센터장	포항공대(박사)	계열회사 임원	11
허준	남	1972.08	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	10
허준영	남	1977.02	상무	상근	네트워크 People팀장	구주총괄 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	22
허준희	남	1979.03	상무	상근	System LSI CP개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	27
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허진욱	남	1971.09	상무	상근	북미총괄 CS팀장	ECSO장	한양대(박사)	계열회사 임원	34
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	34
헨릭얀손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 담당임원	Ericsson, VP	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	9
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34

현상진	남	1972.02	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	58
현재용	남	1975.09	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	Fusion-io, Fellow	RPI(석사)	계열회사 임원	2
현정혁	남	1977.09	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	10
홍경선	남	1970.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	58
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI AP설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	22
홍연석	남	1972.01	상무	상근	SEIN-P법인장	무선 Global제조센터 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	22
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	22
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	58
홍정호	남	1969.02	상무	상근	의료기기 지원팀장	전장사업팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	남	1971.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	58
홍준식	남	1971.12	상무	상근	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	34
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	45
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 시스템솔루션팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	남	1970.10	상무	상근	창의개발센터장	신사업T/F 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	58
황영삼	남	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	10
황관구	남	1972.02	상무	상근	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	22
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	45
황인철	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	Samsung Research Global 시센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	58
황일권	남	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	10
황호승	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	34
황희돈	남	1974.01	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	45

- ※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 98,157,239주(이재용 회장 97,414,196주 등), 우선주(의결권 없는 주식) 173,745주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.
- ※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
- ※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	안유정	여	1974.08	부사장	디자인경영센터 담당임원	계열회사 임원
	이병원	남	1972.05	부사장	IR팀 담당임원	계열회사 임원
	이제석	남	1969.01	부사장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	계열회사 임원
	윤원주	남	1978.01	상무	메모리 DRAM개발실 담당임원	계열회사 임원
	이성준	남	1981.10	상무	Foundry Corporate Planning실 담당임원	계열회사 임원
	이승민	남	1981.03	상무	Mobile eXperience CX실 담당임원	계열회사 임원
	정직한	남	1974.11	상무	Mobile eXperience 서비스Biz팀 담당임원	계열회사 임원

- ※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기·사업보고서에 기재 예정)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2023년 3분기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채우자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	96,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	777,000	857,000	239,395	27,212	266,607	48.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	25,649	△19,432	6,217	17.0%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.05.31	832,572	801,294	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.01	2024.09.05	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	45,000	20,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.01.18	2023.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
합 계							8,146,572	8,115,294	430,476	△157,652	272,824	

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2023년 3분기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각/매입	2023.09.30	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	48,407	25,897
SESS	계열회사	자산매각/매입	2023.07.20	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,761	785
SEHC	계열회사	자산매각	2023.07.13	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,054	79
SAS	계열회사	자산매각/매입	2023.07.13	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,163	106
SEV	계열회사	자산매입	2023.03.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	767	-
TSLED	계열회사	자산매각/매입	2023.09.02	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	733	522
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2023.09.18	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	549	148
SIEL	계열회사	자산매각	2023.08.04	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	210	38
SESK	계열회사	자산매각	2023.07.05	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	153	-

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일·30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 2023년 3분기 중 계열회사인 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEA	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.09	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	23,465,464
SEVT	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.09	스마트폰 매출입 등	18,834,480
SSI	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.09	반도체 매출 등	15,231,321
SEV	계열회사	매출입 등	2023.01~2023.09	스마트폰 매출입 등	12,422,313

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주) 등)는 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.08.19	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2022.10.01	2023.12.16	409,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2022.12.17	2024.06.13	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	110,000	96,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	777,000	857,000	239,395	27,212	266,607	48.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.12.16	130,000	130,000	25,649	△19,432	6,217	17.0%
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.05.31	832,572	801,294	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	150,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	537,000	537,000	155,768	△155,768	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	60,000	60,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.01	2024.09.05	888,400	888,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SMBC	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	45,000	20,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	15,600	15,600	9,664	△9,664	-	
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	404,000	404,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2022.11.09	2024.06.13	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2022.12.17	2023.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	20,000	20,000	-	-	-	
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023.01.18	2023.12.16	-	10,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2022.11.09	2023.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman International Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	603,960	609,199	513,366	4,453	517,819	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	계열회사	ANZ	지급보증	시설자금	2022.11.10	2025.11.09	20,000	20,000	20,000	-	20,000	7.1%
합 계							9,110,532	9,084,493	963,842	△153,199	810,643	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이(주), SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은
 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이(주)의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을
 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.
 한편, 삼성디스플레이(주)는 SDN에게 2022년 중 US\$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
 .(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에
 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기·사업보고서에 기재 예정)

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Neo QLED 8K (2021.03. ~2023.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (55 · 65 · 75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가
	Neo QLED 4K (2021.03. ~2023.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") □ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look <ul style="list-style-type: none"> - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현
	OLED TV (~2023.08.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65 · 77") <ul style="list-style-type: none"> - S95 (55 · 65 · 77") / S90 (55 · 65 · 77") - Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는 QD-Display TV □ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (83") <ul style="list-style-type: none"> - S90 (83") - Neo QLED 외, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 내 포지셔닝 확대를 위해 자발광 디스플레이 특성 활용, 최박부 Slim함을 강조한 Laser Slim Design에 OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
	QLED TV (~2023.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Flat QLED 4K TV (43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar 3.0을 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대
	UHD TV (~2023.03.)	<ul style="list-style-type: none"> □ Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화
	영상디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> □ The Sero (43") <ul style="list-style-type: none"> - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 □ The Serif (43 · 49 · 55 · 65") <ul style="list-style-type: none"> - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 □ The Terrace (55 · 65 · 75")

		<ul style="list-style-type: none"> - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 <input type="checkbox"/> The Premiere (100~130") <ul style="list-style-type: none"> - 초단초점 · 레이저 · 고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝터 <input type="checkbox"/> The Freestyle (30~100") <ul style="list-style-type: none"> - 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
	Micro-LED TV (~2023.06.)	<input type="checkbox"/> The Wall 2.0 (110") <ul style="list-style-type: none"> - Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시 - 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen - 해상도 제약없이, 실재를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질 <input type="checkbox"/> Micro-LED Screen (89 · 101") <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족 시켜 주는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
	Sound Bar (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Sound Bar <ul style="list-style-type: none"> - TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품 - 음성 인식 AI Solution 채용 - 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현 <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재
	모니터 (2021.01. ~2023.09.)	<input type="checkbox"/> 스페이스 모니터 <ul style="list-style-type: none"> - 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용 <input type="checkbox"/> Neo QLED 게이밍 모니터(49") <ul style="list-style-type: none"> - Neo QLED 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화 - 세계 최고 곡률 1000R 적용하여 게이밍 몰입 강화 <input type="checkbox"/> 고해상도 QHD 모니터(34") <ul style="list-style-type: none"> - Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공 <input type="checkbox"/> LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) <input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") <ul style="list-style-type: none"> - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) <input type="checkbox"/> 게이밍 모니터 G85NB (32") <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) <input type="checkbox"/> 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") <ul style="list-style-type: none"> - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 <input type="checkbox"/> QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") <ul style="list-style-type: none"> - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현

			<ul style="list-style-type: none"> - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 <input type="checkbox"/> 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈 보호하는 Matte Display - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' <input type="checkbox"/> DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57") <ul style="list-style-type: none"> - 신규 57" 초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공 - 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
		<p>사이니지 (~2023.06.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall, Outdoor 등) (13 · 24 · 32 · 43 · 49 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항공 코팅 <input type="checkbox"/> FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터랙티브 제품
	<p>생활가전</p>	<p>냉장고 (~2023.06.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 북미/중남미 신규 TMF <ul style="list-style-type: none"> - 대용량, 전문보관, New Design으로 경쟁력 강화 및 제품 차별화(440L/480L) - Flex Zone(Fridge 1℃ / Chilled -1℃ / Soft Freezing) & Quick Chill Smart Alarm - Flat Door & Bespoke CMF, 용량 및 최적 사이즈로 경쟁력 강화(20L More) - Bi Volt(Free Voltage), Auto Ice Maker, Water Dispenser, Big Box, Hygiene <input type="checkbox"/> 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인) <ul style="list-style-type: none"> - Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용 - Auto Door Open - Water & Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice) <input type="checkbox"/> 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 <input type="checkbox"/> 북미 48"냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 <input type="checkbox"/> 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가)
		<p>세탁기 (~2022.01.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BESPOKE 세탁기 & 건조기 <ul style="list-style-type: none"> - 당신의 공간에 딱 맞추는 비스포크 Flat 디자인 - 국내 최대 용량 올인원 컨트롤 UX 디자인 - 세탁부터 건조까지 AI 의류 케어(AI 맞춤세탁, 건조) - 99.9% 살균부터 세탁실 제습까지 위생관리 솔루션 <input type="checkbox"/> Agitator 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> - 북미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유) - ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 영킹 줄이는 동시에 강력 세탁 가능 - 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능

		<p><input type="checkbox"/> 구주향 친환경 신냉매 건조기</p> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용 - 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성 - Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단 - Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정) - Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균 <p><input type="checkbox"/> 그랑데 AI 24kg 세탁기</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24kg, Flat Design (Glass Type) - 핏케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알려진 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) <p><input type="checkbox"/> BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design - 핏케어 코스 적용(탈제거 특화), - Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림) - 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공
	<p>에어컨 (~2023.05.)</p>	<p><input type="checkbox"/> 무풍 갤러리 스탠드 에어컨(56.9 · 62.6 · 75.5 · 81.8 · 92.5㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 에너지 우위 확보가 가능한 최고 효율 Next 무풍 플랫폼 개발(56.9㎡ 싱글 에너지 2등급 달성) - 1.5배 넓어진 무풍 면적(패널)과 강력한 부스터풍 - 부스터 청정: 집진효율 99.95% 필터, 가구같이 편안한 갤러리 디자인 <p><input type="checkbox"/> 무풍 벽걸이 와이드 에어컨(24.4 · 29.3 · 39.6 · 49.5㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"> - QMD 기반의 신규 통합 플랫폼 개발로 원가경쟁력 확보, 제품 경쟁력 강화 - 12% 더 커진 팬으로 빠르고 시원한 패스트 쿨링 - 전기료 부담을 최대 77% 덜어주는 무풍 미세 초절전 - 초미세먼지까지 제거하는 PM1.0 필터시스템의 무풍청정 <p><input type="checkbox"/> BESPOKE 원도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 실내외기 일체형으로 셀프 간편 설치 - 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방 - 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&저진동 - 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전 <p><input type="checkbox"/> 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 <p><input type="checkbox"/> BESPOKE 무풍에어컨 원도우핏</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 <p><input type="checkbox"/> Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엷지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드
	<p>상업용에어컨 (2023.08.)</p>	<p><input type="checkbox"/> 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응

		<ul style="list-style-type: none"> - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A))
	청소기 (~2023.09.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 스틱 청소기(최고 흡입력 210W) <ul style="list-style-type: none"> - 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display) - 물분사 물걸레 브러시, 슬림 용 브러시 <input type="checkbox"/> 제트봇 AI 로봇 청소기 <ul style="list-style-type: none"> - Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1㎡) 감지 실현으로 걸림 없는 주행 - 우리집 구조와 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행 - 제트 싸이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력 - 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션 - SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤) <input type="checkbox"/> BESPOKE 슬림 스틱 청소기 <ul style="list-style-type: none"> - 강력한 싸이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력 - 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP & SHOOT) - 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계) <input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) <ul style="list-style-type: none"> - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 <input type="checkbox"/> 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 <ul style="list-style-type: none"> - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소
	조리기기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 큐커(Qooker) <ul style="list-style-type: none"> - 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티쿡" - Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용 - 식품사(8개 회사)와 연계 큐커 전용 알고리즘 적용 - SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현 - 열효율 및 고급감 STS 조리실: 법랑 → STS 적용
	렌지후드 (2022.02.)	<input type="checkbox"/> 자가 후드 프리미엄 라인업 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품과의 성능 차별화 <ul style="list-style-type: none"> · 트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전 · 업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증) - 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선 - 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(비스포크 컬러) - Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입
	정수기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> 가정용 Water Purifier <ul style="list-style-type: none"> - 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기 - 소비자 Needs에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수) - Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터 - 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』
	의류관리기 (2021.05.)	<input type="checkbox"/> 슈드레서 <ul style="list-style-type: none"> - 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취 - 매일 신는 신발 기분좋게 저온성세 건조 - 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균 - 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리

		인버터 제습기 (2022.05.)	<input type="checkbox"/> 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 <ul style="list-style-type: none"> - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
		식기세척기 (2022.06.)	<input type="checkbox"/> 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> - 구주 시장 Tall Tub 대응 - 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
		가스오븐 (~2023.08.)	<input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range <ul style="list-style-type: none"> - 48"all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 <input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel) <ul style="list-style-type: none"> - 48"Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스) - Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용 - Small oven 12"(신규 플랫폼), Big oven 36"(기존 플랫폼)조합 - Steam Assist 기능 제공
	MX	갤럭시 폴더블 (~2023.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 158.2mm x 67.1mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 158.2mm x 128.1mm x 6.4mm - Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 7.6"인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상 - 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원 - 폴더블폰 최초로 S펜 적용 - 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원 - 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원 <input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 72.2mm x 86.4mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 72.2mm x 166mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 커버 디스플레이 사용성 강화 : 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결제 지원 - 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레임링(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원 - 메인 디스플레이 120Hz 화면 주사율 지원 <input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold4 (2022.08.)

			<ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 155.1mm x 67.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때) 155.1mm x 130.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능 <p>☐ Galaxy Z Flip4 (2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각도로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등) <p>☐ Galaxy Z Fold5 (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 154.9mm x 67.1mm x 13.4 mm (펼쳤을 때) 154.9mm x 129.9mm x 6.1 mm - Platform(H/W, S/W): SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(몰방울형) Flex Hinge 적용 - 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그림감 향상 - 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선 <ul style="list-style-type: none"> ·양손 활용 동작 : 한 손으로 앱 /컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행 ·Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장 ·멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환 ·Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 - 슬림하고 가벼운S-Pen과 Case : S-Pen 및Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감 <p>☐ Galaxy Z Flip5 (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 3.4" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 85.1mm x 15.1 mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.1mm x 6.9 mm - Platform(H/W, S/W): SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4") - 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소로 그림감 개선 - 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화 <ul style="list-style-type: none"> ·주요 위젯13종(Music, Alarm 등), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공 ·Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종) - 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공 - 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경 <p>☐ Galaxy S21 5G · S21+ 5G · S21 Ultra 5G (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design - 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8" - 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm,
		<p>갤럭시 S (~2023.02.)</p>	<p>☐ Galaxy S21 5G · S21+ 5G · S21 Ultra 5G (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design - 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8" - 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm,

			<p style="text-align: center;">S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Exynos2100, SDM888, Android 11.0, One UI 3.1 - 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재 · 카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21 · S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능 · 최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재 · SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록 · 찾기 기능 지원 · Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G · S21 Ultra 5G only) · S Pen 지원(S21 Ultra 5G only) <hr/> <p>□ Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, <p style="text-align: center;">S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): SM8450 Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화 · 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer 성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 · 저조도 성능 강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 · One UI 4.1: 감성적 Interaction 경험과 사용자 개인 경험 고도화 · Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화 <hr/> <p>□ Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond <li style="padding-left: 20px;">* Unrivalled Camera, Ultimate Gaming, Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, 168g, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g <p style="text-align: center;">S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 AI 기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 · AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 · OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5° → S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 · S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 · 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 · 소모전류 개선 및 발열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 · 단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 · 이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) · 폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 · 패키징 박스 100% 재생용지 사용 · 재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> · 전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 · 보안 상태 시각화/ 이미지 공유시 민감 정보 알림/ 제품 수리시 개인 정보 접근 제한
		<p style="text-align: center;">갤럭시 탭 (~2023.08.)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>□ Galaxy Tab S7 FE (2021.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 12.4" WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 284.8mmx 185mm x 6.3mm, 608g(LTE 기준) - 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이 - 긴 배터리 사용시간 (10,090mAh, Up to 13 hours video play) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - Samsung Note 사용성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 간편하게 손글씨를 TEXT로 변환 · 입력창에 직접 S Pen으로 입력 - PENUP Drawing 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · Layer 구조 적용 및 컬러링 & 라이브 드로잉 제공 - 경량화 키보드 커버 (330g) - 3Mic를 통한 주변 Noise 50%감소로 깨끗한 보이스 전달 - Device 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 · Hand off: Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes) · Copy & Paste: Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 & 붙이기 · Auto Switching: 자동으로 Phone/Tablet 간 버즈 스위칭 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>□ Galaxy Tab A8 (2021.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 10.5" WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 246.8mm x 161.9mm x 6.9mm, 508 g - Platform(H/W, S/W): UniSOC T618(12nm) 프로세서, Android 11, One UI 3 - Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB 전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공 - 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold) - 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5" 대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제 공 - Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 콘텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공) - Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag & Split 태블릿 최초 지 원으로 멀티태스킹 경험 강화 - Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화 - One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&Paste, Auto Sync, Auto Switch) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>□ Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S8 11" WQXGA+ (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 253.8mm x 165.3mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 285.0mm x 185.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 326.4mm x 208.6mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): SM8450 프로세서, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16GB+512G, microSD up to 1TB </div>

			<ul style="list-style-type: none"> - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancellation 성능 강화 (3중 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축 <p>□ Galaxy Tab S9 · S9+ · S9 Ultra (2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) <li style="padding-left: 20px;">Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) <li style="padding-left: 20px;">Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S9 165.8 x 254.2 x 5.9 mm, 498g <li style="padding-left: 20px;">Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g <li style="padding-left: 20px;">Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 풍부한 색감과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 · Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 · 햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 · 최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 · 충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum · 양방향 충전 적용 S-Pen 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 · Tab FE 모델군과 키보드 및 액세서리 공용화로 호환성 강화 · Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 · 필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 · 그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨전, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 · S-PEN 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 · 디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) · 패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 <p>등</p> <p>□ Galaxy A52 LTE · 5G (2021.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1 - Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest <li style="padding-left: 20px;">(6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit) - High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro) - Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh) <p>□ Galaxy A72 (2021.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm
		<p>갤럭시 A (~2023.05.)</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : SDM720G, Android 11, One UI 3.1 - High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit) - Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro) - Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh)
		<input type="checkbox"/> Galaxy A32 LTE · 5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720) - 사이즈(W x H x D) : LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm - Platform(H/W, S/W) : LTE MT6769T / 5G MT6853V, Android 11, One UI 3.1 - LTE <ul style="list-style-type: none"> · Brightest Display: 800nit Super AMOLED · High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth) · High Capacity Battery: 5,000mAh - 5G <ul style="list-style-type: none"> · Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth) · High Capacity Battery: 5000mAh 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" QHD+ (3200 x 1440) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g - Platform(H/W, S/W) : SDM855+, Android 11, One UI 3.1 - QRNG 보안칩셋 적용 - 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원 - 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP) 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A03-Core (2021.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" HD+(720x1600) TFT 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 164.2mm x 75.9mm x 9.1mm, 211g - Platform(H/W, S/W) : 28나노 옥타코어 프로세서, Android 11(Android GO) <ul style="list-style-type: none"> · 전작 A01-Core(28나노 쿼드코어 프로세서) 대비 CPU 성능 향상 - Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품 <ul style="list-style-type: none"> · 전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A23 (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A13 5G (2022.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP 성능 강화 (MT6765 → MT6833V) - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A13 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2400 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : 8나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능
		<input type="checkbox"/> Galaxy A73 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display 적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A53 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작비 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A33 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A23 5G (2022.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2408) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G MT6833V) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" HD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A14 5G (2023.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : MT6833V/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 	
		<input type="checkbox"/> Galaxy A54 5G (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 <p>□ Galaxy A34 5G (2023.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : MT6877V, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공 <p>□ Galaxy A14 (2023.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/MT6769T, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 <p>□ Galaxy A24 (2023.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : MT6789V, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공 <p>□ Galaxy Book Go (2021.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 14" FHD (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g - Platform : 2세대 스냅드래곤 7C, Windows 10 - 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원 - 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life) - Tablet, Phone 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> • Quick Share : Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유 • Second Screen : Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 • Galaxy Book Smart Switch : 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송 • SmartThings : 스마트 기기 연동 <p>□ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% <li style="padding-left: 40px;">13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg <li style="padding-left: 40px;">13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support
		<p>갤럭시북 (~2023.02.)</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3"63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> · QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <p>□ Galaxy Book2 Pro (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6"FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3"FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg 13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6"Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6"Only) 지원 - Battery : 15.6"68Wh (21hrs), 13.3"63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> · QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <p>□ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.6mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform : WoA 7C+ Gen3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (7C Gen2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 <ul style="list-style-type: none"> · Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity <p>□ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 13.3"FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine <p>□ Galaxy Book3 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0"OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K)
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - 사이즈(W x D x H) : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg, - 인텔 RPL-H i7/i9, Win 11, LPDDR5, nVidia RTX 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (갤럭시 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 <ul style="list-style-type: none"> · Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 · Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 · Quick Share : 폰/태블릿 등 갤럭시 기기 간 무선 파일 공유 <hr/> <p>□ Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0"WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 120%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0"355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원 - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p>□ Galaxy Book3 Pro (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% 14"WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg 14"312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p>□ Galaxy Book3 360 (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% 13.3"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6"355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg 13.3"304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120%
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WIFI 6E 지원 - Battery : 15.6"68Wh, 13.3"61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
		갤럭시 워치 (~2023.08.)	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <p>□ Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic(2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: Watch4 : (44mm) 1.4" (450 x 450), (40mm) 1.2"(396 x 396) Watch4 Classic : (46mm) 1.4" (450 x 450), (42mm) 1.2"(396 x 396) - 사이즈(W x H x D) : Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm - Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920(5나노 64비트 Dual-Core), Wear OS Powered By Samsung, One UI Watch 버전 3.0 - Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공 - 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선 - 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진 - 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화 - Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화 <ul style="list-style-type: none"> · Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공 · 최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <p>□ Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro(2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능 <ul style="list-style-type: none"> · 체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) <ul style="list-style-type: none"> · 기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/사이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 · 마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 · 경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 · 트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공 · 큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능 </div> <div style="padding-bottom: 5px;"> <p>□ Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic(2023.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 Classic (43mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480) Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch6 Classic (47mm) : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g Watch6 Classic (43mm) : 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0 g </div>

			<p>Watch6 (44mm) : 44.4 x 42.8 x 9.0 mm, 33.3g</p> <p>Watch6 (40mm) : 40.4 x 38.8 x 9.0 mm, 28.7g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) - 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능 <ul style="list-style-type: none"> · 전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현 · 고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원 - 강화된 수면 관리 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공 · 향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가 <ul style="list-style-type: none"> · 심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에 개인화된 운동 가이드 제공 · 트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록 · 불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용 - One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체 - 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 47/44mm 425mAh, 43/40mm 300mAh 적용
		<p>갤럭시 버즈 (~2022.08.)</p>	<p>□ Galaxy Buds Pro (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design : Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm - Platform(H/W, S/W) : BCM43015, RTOS - 2Way(Woofers + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상 <ul style="list-style-type: none"> · 3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공 · 커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환 · 영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공 - IPx7 등급 방수 지원 <p>□ Galaxy Buds 2 (2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화 - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm - BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 <ul style="list-style-type: none"> · ANC 기능 제공 · 음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준) - Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화 - Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화 <ul style="list-style-type: none"> · DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU) * DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit · 자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms) · Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화 · 무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화 · 통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선 · Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선 <p>□ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS

			<ul style="list-style-type: none"> · 당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC · 멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는360 Audio 청취 경험 강화 · 개선된VPU와 개인화Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공 - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 · 전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기출 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 · 오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 워치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환
네트워크		RAN S/W Package (2021.06.)	<input type="checkbox"/> SVR21B NR vDU SW Package (2021.06.) <ul style="list-style-type: none"> - TDD 기반 C-Band vDU · H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능 * vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현
		기지국 (2021.02.~2023.05.)	<input type="checkbox"/> MMU Beam Forming SOC 개발 (2021.02.) <ul style="list-style-type: none"> - MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SOC로 구현 - 기존 소모 전력의30% 수준으로 감축(최대 소모전력40W 이하) <input type="checkbox"/> 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.) <ul style="list-style-type: none"> - DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능 - AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W <input type="checkbox"/> 북미향 AWS/PCS Dual Band 16T16R FDD MMU (2021.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초16T16R FDD Dual Band MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용) <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 <input type="checkbox"/> 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) <ul style="list-style-type: none"> * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 <input type="checkbox"/> Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) <ul style="list-style-type: none"> - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수 : n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) <input type="checkbox"/> Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 국내향 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내향 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가 <input type="checkbox"/> 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화 <input type="checkbox"/> 북미향 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 1세대 대비 고효율화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발
DS 부문	메모리	모바일용 DRAM (2021.11.~2023.09.)	<input type="checkbox"/> 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선 - 업계 최첨단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대 - 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(8.5Gbps) 검증

			<input type="checkbox"/> 업계 최초 LPCAMM 개발 <ul style="list-style-type: none"> - LPDDR 기반 모듈 개발로 PC·노트북 등 차세대 모듈 시장 선도 - SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및 교체·업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대 - 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및 차세대 PC·노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대
		<p>서버용 DRAM (2021.03.~2023.09.)</p>	<input type="checkbox"/> 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발 <ul style="list-style-type: none"> - High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현 - 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상 - 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정 <input type="checkbox"/> 업계 최선단 12나노급 D램 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 차세대 컴퓨팅 최적화 - 고유전을 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 <input type="checkbox"/> 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의 모듈 대비 소비 전력 10% 개선 - AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 연내 양산 예정으로AI, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
		<p>그래픽 DRAM (2022.07.~2023.07.)</p>	<input type="checkbox"/> 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 3세대 10나노급(1z) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 <input type="checkbox"/> 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 <ul style="list-style-type: none"> - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 <input type="checkbox"/> 업계 최초 GDDR7 D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상 - 패키지 신소재 적용·회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대
		<p>HBM DRAM (2021.02.~2022.10.)</p>	<input type="checkbox"/> 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소 - 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월) - 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능 - 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 에코 시스템 구축 협력 <input type="checkbox"/> 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발) <ul style="list-style-type: none"> - 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소) - D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소

		<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 시용 가속기 구현 <ul style="list-style-type: none"> - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대
	NAND (2022.11.)	<ul style="list-style-type: none"> □ '8세대 V낸드' 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보 - 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대
	eStorage (2022.05.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 <ul style="list-style-type: none"> - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 - 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
	서버용 SSD (2021.02.~2022.07.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산 - 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족 - 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여 □ 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원 - 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공 - 전력효율 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대 □ 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용 - 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용 - AI, 빅데이터, IOT 등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대 □ PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발 <ul style="list-style-type: none"> - PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선 - 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장 □ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨터이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대
	Client SSD (2023.01.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원
	브랜드 SSD (2021.01.~2023.09.)	<ul style="list-style-type: none"> □ 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용 - 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상 - 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국·미국·독일·중국 등 40여개국 순차 출시 □ 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시

			<ul style="list-style-type: none"> - 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공 - 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용 - 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재 - 970 EVO 대비 전력효율 56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능 <p><input type="checkbox"/> 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 <p><input type="checkbox"/> 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공 <p><input type="checkbox"/> 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로 PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공 - 고성능 게임, 3D/4K 그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화 - 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화
	EUV (2021.10.)		<p><input type="checkbox"/> 업계 최첨단 14나노 EUV DDR5 D램 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상 - DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선
	CXL (2021.05. ~2023.05.)		<p><input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복, 용량 대역폭의 획기적인 확장 가능 - CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 에러 관리 등 지원 - 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소 <p><input type="checkbox"/> 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선 - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약 2배 이상 성능이 향상 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로 시장 선도
	복합칩 (2021.06.)		<p><input type="checkbox"/> 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상 - 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인
	브랜드 Card (2021.09. ~2023.08.)		<p><input type="checkbox"/> 성능·안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배 - 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배 - 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라

			<p>4K UHD 영상과 같은 고사양의 콘텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대</p> <p><input type="checkbox"/> 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영 <p><input type="checkbox"/> 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원, 기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수·낙하·마모·엑스레이·온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터 보호 - 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에 최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공
		Automotive (2023.07.)	<p><input type="checkbox"/> Automotive용 메모리 토털 솔루션 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - IVI용 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD용 2GB GDDR6, 128GB UFS - 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안전성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원) <p><input type="checkbox"/> 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로 전기차, 자율주행차 등에 최적화 - 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도 700MB/s 제공 - 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화
	System LSI	이미지센서 (2021.01.~2023.09.)	<p><input type="checkbox"/> 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.8um 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적 - '스마트 ISO 프로'로 잔상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능 - 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용... 초점 검출 능력 50% 향상 - 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감 <p><input type="checkbox"/> 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용 - 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영 - 스테퍼드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용 - 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용 - 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축 <p><input type="checkbox"/> 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정 - 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션 <p><input type="checkbox"/> 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1' - 업계 최소 크기의 듀얼 픽셀 이미지센서 '아이소셀 GN5' <p><input type="checkbox"/> 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현 - '테트라 스캐어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - AI기반의 화질처리 솔루션 구현으로 2억화소 화질 해상도 개선 및 5천만 화소 센서 중 활용도

			<p>향상</p> <p><input type="checkbox"/> 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 <p><input type="checkbox"/> 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 5나노 EUV 공정 · 최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상 - 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선 - 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산 - 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용 - 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등 <p><input type="checkbox"/> EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상 - 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현 - 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상 - 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊임없이 고용량 · 고화질 콘텐츠 이용 가능 - 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원 <p><input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용 - 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원 - 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공 <p><input type="checkbox"/> 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상 <p><input type="checkbox"/> 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 <p><input type="checkbox"/> UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칩으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 <p>LSI (2021.01.~2023.03.)</p> <p><input type="checkbox"/> DDR5 D램 모듈용 전력관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종 - 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상 - 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화 <p><input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화 <input type="checkbox"/> 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C) <ul style="list-style-type: none"> - 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
	Foundry	2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	<input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용 <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상
		8나노 RF 공정 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> - 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공 <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화 <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - RFFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소
		2.5D 반도체 패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.)	<input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' <ul style="list-style-type: none"> - 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현 - 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 전담하는 이중 구조 - 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소 - 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소 - 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화
		세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ <input type="checkbox"/> GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 <ul style="list-style-type: none"> - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 <input type="checkbox"/> 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 <input type="checkbox"/> 고성능·저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획
SDC	디스플레이 패널	갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.)	<input type="checkbox"/> 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> - S21 시리즈: 6.24" · 6.67" · 6.81" QHD+(3,200×1,440) - 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선 - 휘도·명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 →500/1100nit, Peak 1,785nit) → Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안전인증회사)
		갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개발 (2021.08.)	<input type="checkbox"/> 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감
		55/65" QD-Display (2022.01.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 TV형 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) <ul style="list-style-type: none"> - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
		34" QD-Display (2022.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 모니터형 QD-Display (34" QHD) <ul style="list-style-type: none"> - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화

	<p>갤럭시Z 폴드4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.)</p>	<p>□ 전작비 추가적인 개선 진행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조 - 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감
<p>3.36" 850ppi 초고해상도VR 개발 (2023.02.)</p>	<p>□ 초고해상도 (850ppi) OLED 적용 VR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screen Door Effect Free solution 으로 체감 해상도 1,100 ppi 달성 - 기존 Square 대비 Round Shape 적용으로 Set Design 자유도 향상 	
<p>갤럭시북3 프로용 14/16" OLED개발 (2023.02.)</p>	<p>□ 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상용화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용 - 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화 - 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소 	
<p>HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)</p>	<p>□ OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10) - 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제 공 	
<p>Google Pixel 8pro용 OLED개발 (2023.10.)</p>	<p>□ 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고휘도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전력 구현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992) - 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용 	

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계